

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2022年9月29日(29.09.2022)



(10) 国際公開番号

WO 2022/201620 A1

(51) 国際特許分類:

C08G 73/12 (2006.01) C08L 79/08 (2006.01)
B32B 15/08 (2006.01) C09J 179/04 (2006.01)
B32B 27/26 (2006.01) H01L 23/29 (2006.01)
B32B 27/34 (2006.01) H01L 23/31 (2006.01)
C08J 5/24 (2006.01) H05K 1/03 (2006.01)
C08K 5/5397 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2021/040619

(22) 国際出願日: 2021年11月4日(04.11.2021)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2021-052293 2021年3月25日(25.03.2021) JP

(71) 出願人: 日本化薬株式会社(NIPPON KAYAKU KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒1000005 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 山本 和義(YAMAMOTO Kazuyoshi); 〒1158588 東京都北区志茂3-3-1-12 日本化薬株式会社 機能化学品研究所内 Tokyo (JP). 水口 貴文(MIZUGUCHI Takahumi); 〒1158588 東京都北区志茂3-3-1-12 日本化薬株式会

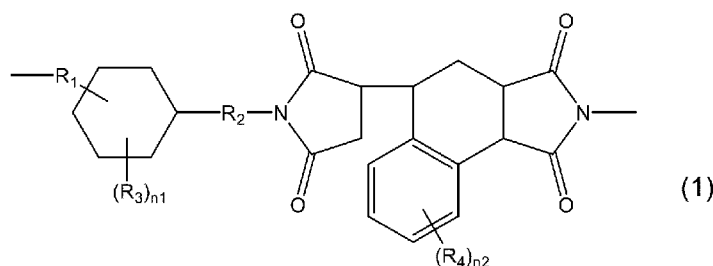
社 機能化学品研究所内 Tokyo (JP). 吉澤 恵理(YOSHIZAWA Eri); 〒1158588 東京都北区志茂3-3-1-12 日本化薬株式会社 機能化学品研究所内 Tokyo (JP). 竹田 麻央(TAKEDA Mao); 〒1158588 東京都北区志茂3-3-1-12 日本化薬株式会社 機能化学品研究所内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 木内 光春, 外(KIUCHI Mitsuharu et al.); 〒1050003 東京都港区西新橋1丁目6番13号 虎ノ門吉荒ビルディング5階 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(54) Title: RESIN COMPOSITION, CURED OBJECT, RESIN SHEET, PREPREG, METAL-CLAD LAMINATE, MULTILAYERED PRINTED WIRING BOARD, SEALING MATERIAL, FIBER-REINFORCED COMPOSITE MATERIAL, ADHESIVE, AND SEMICONDUCTOR DEVICE

(54) 発明の名称: 樹脂組成物、硬化物、樹脂シート、プリプレグ、金属箔張積層板、多層プリント配線板、封止用材料、繊維強化複合材料、接着剤及び半導体装置



(57) Abstract: This resin composition comprises a bismaleimide compound (A) including a constituent unit represented by formula (1) and containing maleimide groups at both ends of the molecular chain, at least one resin or compound (B) selected from the group consisting of maleimide compounds other than the bismaleimide compound (A), cyanic acid ester compounds, benzoxazine compounds, epoxy resins, carbodiimide compounds, and compounds having an ethylenically unsaturated group, and a photocuring initiator (C). (In formula (1), R₁ represents a linear or branched C1-C16 alkylene group or a linear or branched C2-C16 alkenylene group, R₂ represents a linear or branched C1-C16 alkylene group or a linear or branched C2-C16 alkenylene group, the R₃ moieties each independently represent a hydrogen atom, a linear or branched C1-C16 alkyl group, or a linear or branched C2-C16 alkenyl group, n¹ each independently indicates an integer of 1-4, and n² each independently indicates an integer of 1-4.)

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

(57) 要約: 本発明の樹脂組成物は、式(1)で表される構成単位と、分子鎖の両末端にマレイミド基と、を含む、ビスマレイミド化合物(A)と、ビスマレイミド化合物(A)以外のマレイミド化合物、シアン酸エステル化合物、ベンゾオキサジン化合物、エポキシ樹脂、カルボジイミド化合物、及びエチレン性不飽和基を有する化合物からなる群より選択される少なくとも1種以上の樹脂又は化合物(B)と、光硬化開始剤(C)と、を含む、樹脂組成物。(式(1)中、 R_1 は、炭素数1~16の直鎖状若しくは分岐状のアルキレン基、又は炭素数2~16の直鎖状若しくは分岐状のアルケニレン基を示す。 R_2 は、炭素数1~16の直鎖状若しくは分岐状のアルキレン基、又は炭素数2~16の直鎖状若しくは分岐状のアルケニレン基を示す。 R_3 は、各々独立に、水素原子、炭素数1~16の直鎖状若しくは分岐状のアルキル基、又は炭素数2~16の直鎖状若しくは分岐状のアルケニル基を示す。 n^1 は、各々独立に、1~4の整数を示す。 n^2 は、各々独立に、1~4の整数を示す。)

明 細 書

発明の名称：

樹脂組成物、硬化物、樹脂シート、プリプレグ、金属箔張積層板、多層プリント配線板、封止用材料、繊維強化複合材料、接着剤及び半導体装置

技術分野

[0001] 本発明は、樹脂組成物、硬化物、樹脂シート、プリプレグ、金属箔張積層板、多層プリント配線板、封止用材料、繊維強化複合材料、接着剤及び半導体装置に関する。

背景技術

[0002] 近年、特に先端材料分野の進歩に伴い、より高性能な材料の開発が求められている。例えば、大容量通信機器、スマートフォンのアンテナモジュール、及びノートパソコンのケーブル系統向け材料、ミリ波レーダー向け材料、並びに、車のオートブレーキ装置関連機器等の用途に対し、より優れた誘電特性、耐熱性、低応力、耐水性、接着性等の要求が、電子回路基板に対して高まっている。

[0003] 多層プリント配線板の小型化、及び高密度化により、多層プリント配線板に用いられる積層板を薄型化する検討が盛んに行なわれている。薄型化に伴い、絶縁層についても薄型化が求められ、ガラスクロスを含まない樹脂シートが求められている。絶縁層の材料となる樹脂組成物は熱硬化性樹脂が主流であり、絶縁層間で導通を得るための穴あけは一般的にレーザー加工にて行われている。

[0004] 一方、レーザー加工による穴あけは、穴数が多い高密度基板になるほど加工時間が長くなるという問題がある。そのため、近年は光線等の照射により露光部が硬化（露光工程）し、未露光部は除去（現像工程）可能な樹脂組成物を用いることにより、露光、及び現像工程で一括穴あけ加工することが可能となる樹脂シートが求められている。

[0005] 露光の方法としては、水銀灯を光源としてフォトマスクを介して露光する

方法が用いられており、この水銀灯の光源において好適に露光できる材料が求められている。この水銀灯を光源とした露光方法は、g h i 混線（g 線の波長436 nm、h 線の波長405 nm、i 線の波長365 nm）などが用いられており、汎用の光硬化開始剤を選択することができる。また、近年、露光方法として、パターンのデジタルデータに基づいてフォトマスクを介さずに感光性樹脂組成物層に直接描画する直接描画露光法の導入も進んでいる。この直接描画露光法はフォトマスクを介した露光法よりも位置合わせ精度が良好であり、かつ高精細なパターンが得られることから、高密度な配線形成が必要となる基板において、特に導入が進んでいる。その光源はレーザー等の単色光を用いており、中でも高精細なレジストパターンを形成可能なDMD (Digital Micro mirror Device) 方式の装置においては、波長405 nm (h 線) の光源が用いられている。

[0006] 該積層板や樹脂シートに用いられる感光性の樹脂組成物には、露光工程での速やかな硬化を可能にするために（メタ）アクリレート等のエチレン性不飽和基を有する化合物が使用されている。

例えば、特許文献1には、ビスフェノール型エポキシ樹脂と（メタ）アクリル酸とを反応させた後、酸無水物を反応させて得られるカルボキシル変性エポキシ（メタ）アクリレート樹脂と、ビフェニル型エポキシ樹脂と、光硬化開始剤と、希釈剤とを含む感光性熱硬化型樹脂組成物が記載されている。

[0007] また、特許文献2には、光硬化可能なバインダーポリマーと、エチレン性不飽和結合を有する光重合化合物と、光重合（硬化）開始剤と、増感剤と、熱硬化剤であるビスアリルナジックイミド化合物及びビスマレイミド化合物とを含む樹脂組成物が記載されている。

[0008] 特許文献3には、積層板や樹脂シートに用いられる感光性の樹脂組成物として、ビスマレイミド化合物（硬化性樹脂）と、光ラジカル重合開始剤（硬化剤）とを含む樹脂組成物が記載されている。

先行技術文献

特許文献

- [0009] 特許文献1：特開2005-62450号公報
特許文献2：特開2010-204298号公報
特許文献3：WO2018/56466A1

発明の概要

発明が解決しようとする課題

- [0010] しかしながら、従来の（メタ）アクリレート系樹脂を用いた硬化物では十分な物性が得られず、優れた保護膜、及び層間絶縁層の形成に限界がある。
- [0011] 特許文献1に記載の樹脂組成物から得られる硬化物では、ソルダーレジストとして優れた可とう性及び耐折性を有しており、耐熱性にも優れているとの記載はあるが、耐熱性について具体的な値は示されてなく、層間絶縁層として用いるには耐熱性及び熱安定性に劣るとの問題がある。
- [0012] 特許文献2では、ビスマレイミド化合物を用いることが記載されているが、熱硬化剤として記載されており、光重合性化合物としては（メタ）アクリレートを用いている。そのため、層間絶縁層として用いるには耐熱性及び熱安定性に劣るとの問題がある。
- [0013] 特許文献3では、硬化性樹脂としてビスマレイミド化合物を用いているが、通常、マレイミド化合物は光透過性が悪いため、マレイミド化合物を含むと、光硬化開始剤まで十分に光が届かず、光硬化開始剤がラジカルを発生し難く、その反応性は非常に低い。そこで、特許文献3では、現像前に追加加熱を行うことでマレイミド化合物を硬化させているが、加熱を伴うため、高精細なレジストパターンが得られない。また、特許文献3において、波長405nm（h線）を含む活性エネルギー線を照射可能な光源として用いることについては何ら記載されていない。
- [0014] そこで、本発明は、前記問題点に鑑みてなされたものであり、多層プリント配線板に用いた際に、優れた光硬化性を有し、耐熱性、熱安定性及び絶縁信頼性をバランスよく優れる硬化物を得ることができる樹脂組成物、それを用いた樹脂シート、多層プリント配線板、並びに半導体装置を提供することにある。

課題を解決するための手段

[0015] 本発明者らは、特定のビスマレイミド化合物（A）と、特定の樹脂又は化合物（B）と、光硬化開始剤（C）と、を含む樹脂組成物を用いることにより、前記課題を解決できることを見出し、本発明を完成するに至った。

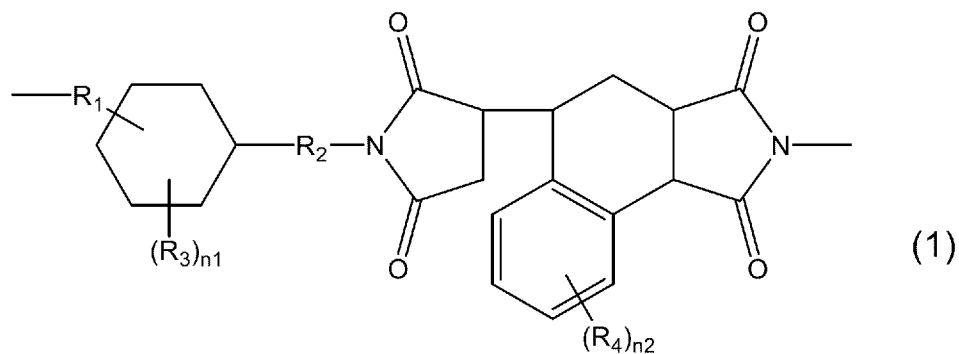
[0016] すなわち、本発明は以下の内容を含む。

[1] 下記式（1）で表される構成単位と、分子鎖の両末端にマレイミド基と、を含む、ビスマレイミド化合物（A）と、

前記ビスマレイミド化合物（A）以外のマレイミド化合物、シアン酸エステル化合物、ベンゾオキサジン化合物、エポキシ樹脂、カルボジイミド化合物、及びエチレン性不飽和基を有する化合物からなる群より選択される少なくとも1種以上の樹脂又は化合物（B）と、

光硬化開始剤（C）と、を含む、樹脂組成物。

[0017] [化1]

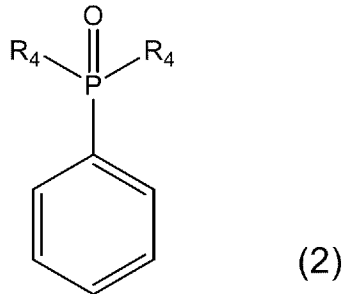


[0018] （式（1）中、 R_1 は、炭素数1～16の直鎖状若しくは分岐状のアルキレン基、又は炭素数2～16の直鎖状若しくは分岐状のアルケニレン基を示す。 R_2 は、炭素数1～16の直鎖状若しくは分岐状のアルキレン基、又は炭素数2～16の直鎖状若しくは分岐状のアルケニレン基を示す。 R_3 は、各々独立に、水素原子、炭素数1～16の直鎖状若しくは分岐状のアルキル基、又は炭素数2～16の直鎖状若しくは分岐状のアルケニル基を示す。 R_4 は、各々独立に、水素原子、炭素数1～6の直鎖状若しくは分岐状のアルキル基、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、又は炭素数1～6の直鎖状若しくは分岐状のアルコキシ基を示す。 n_1 は、各々独立に、1～4の整数を示す。 n_2 は、各

々独立に、1～4の整数を示す。)

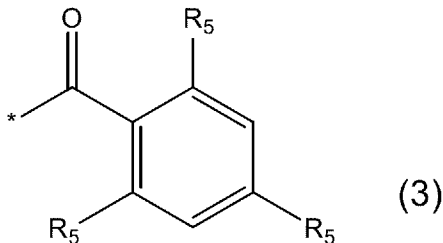
[0019] [2] 前記光硬化開始剤(C)が、下記式(2)で表される化合物を含む、[1]に記載の樹脂組成物。

[0020] [化2]



[0021] (式(2)中、R₄は、各々独立に、下記式(3)で表される置換基又はフェニル基を表す。)

[0022] [化3]



[0023] (式(3)中、-*は結合手を示し、R₅は、各々独立に、水素原子又はメチル基を表す。)

[0024] [3] 前記ビスマレイミド化合物(A)と前記樹脂又は化合物(B)と前記光硬化開始剤(C)の総量を100質量部とした場合、前記(A)一般式(1)で表されるビスマレイミド樹脂の含有量が5～99.4質量部である、[1]～[2]のいずれか一項に記載の樹脂組成物。

[4] 充填材を更に含む、[1]～[3]のいずれか一項に記載の樹脂組成物。

[5] [1]～[3]のいずれか一項に記載の樹脂組成物を含む、硬化物。

[6] 支持体と、前記支持体の片面又は両面に配された樹脂層と、を有し、前記樹脂層が、[1]～[3]に記載の樹脂組成物を含む、樹脂シート。

[7] 前記樹脂層の厚さが1～50 μmである、[6]に記載の樹脂シート。

[8]基材と、前記基材に含浸又は塗布された、[1]～[4]のいずれか一項に記載の樹脂組成物と、を含む、プリプレグ。

[9][7]に記載の樹脂シート、及び[8]に記載のプリプレグからなる群より選ばれる少なくとも 1 種を含む層と、前記層の片面又は両面に配された金属箔と、を有し、前記層が、前記樹脂組成物の硬化物を含む、金属箔張積層板。

[1 0]絶縁層と、前記絶縁層の片面又は両面に形成された導体層と、を有し、前記絶縁層が、[1]～[4]のいずれか一項に記載の樹脂組成物を含む、多層プリント配線板。

[1 1][1]～[4]のいずれか一項に記載の樹脂組成物を含む、封止用材料。

[1 2][1]～ [4]のいずれか一項に記載の樹脂組成物と、強化繊維と、を含む、繊維強化複合材料。

[1 3][1]～[4]のいずれか一項に記載の樹脂組成物を含む、接着剤。

[1 4][1]～[4]のいずれか一項に記載の樹脂組成物を有する、半導体装置。

発明の効果

[0025] 本発明によれば、多層プリント配線板に用いた際に、優れた光硬化性を有し、耐熱性、熱安定性及び絶縁信頼性をバランスよく優れる硬化物を得ることができる樹脂組成物、それをを用いた樹脂シート、多層プリント配線板、並びに半導体装置を提供することができる。

発明を実施するための形態

[0026] 以下、本発明を実施するための形態（以下、「本実施形態」という。）について詳細に説明する。以下の本実施形態は、本発明を説明するための例示であり、本発明を以下の内容に限定する趣旨ではない。本発明はその要旨の範囲内で、適宜に変形して実施できる。

[0027] なお、本明細書における「（メタ）アクリロキシ」とは「アクリロキシ」及びそれに対応する「メタクリロキシ」の両方を意味し、「（メタ）アクリレート」とは「アクリレート」及びそれに対応する「メタクリレート」の両

方を意味し、「(メタ)アクリル」とは「アクリル」及びそれに対応する「メタクリル」の両方を意味する。

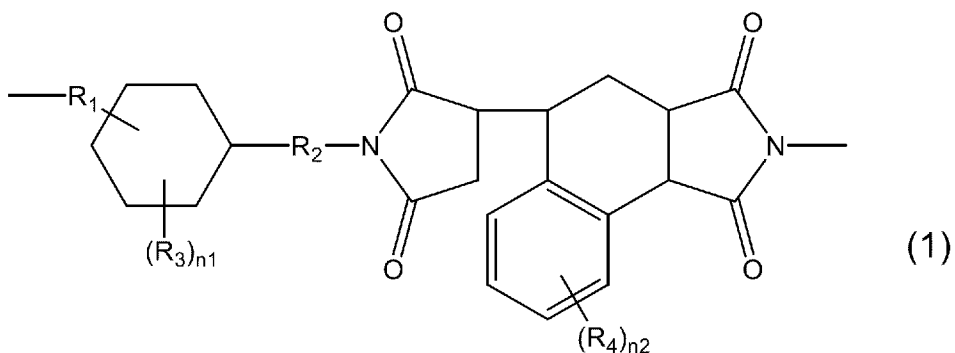
[0028] [樹脂組成物]

本実施形態の樹脂組成物は、特定のビスマレイミド化合物(A)（「成分(A)」とも称す）と、ビスマレイミド化合物(A)以外のマレイミド化合物、シアン酸エステル化合物、ベンゾオキサジン化合物、エポキシ樹脂、カルボジイミド化合物、及びエチレン性不飽和基を有する化合物からなる群より選択される少なくとも1種以上の樹脂又は化合物(B)（「成分(B)」）、又は「樹脂又は化合物(B)」とも称す）と、光硬化開始剤(C)（「成分(C)」とも称す）と、を含む。以下、各成分について説明する。

[0029] [ビスマレイミド化合物(A)]

樹脂組成物は、ビスマレイミド化合物(A)（成分(A)とも称す）を含む。ビスマレイミド化合物(A)は、式(1)で表される構成単位と、分子鎖の両末端にマレイミド基と、を含む。

[0030] [化4]



[0031] 前記式(1)中、 R_1 は、炭素数1～16の直鎖状若しくは分岐状のアルキレン基、又は炭素数2～16の直鎖状若しくは分岐状のアルケニレン基を示す。 R_2 は、炭素数1～16の直鎖状若しくは分岐状のアルキレン基、又は炭素数2～16の直鎖状若しくは分岐状のアルケニレン基を示す。 R_3 は、各々独立に、水素原子、炭素数1～16の直鎖状若しくは分岐状のアルキル基、又は炭素数2～16の直鎖状若しくは分岐状のアルケニル基を示す。 n_1 は、各々独立に、1～4の整数を示す。 n_2 は、各々独立に、1～4の整数を示す。

す。

[0032] 通常、マレイミド化合物は光透過性が悪いため、樹脂組成物がマレイミド化合物を含むと、樹脂組成物中に分散している光硬化開始剤まで十分に光が届かず、光硬化開始剤がラジカルを発生し難い。そのため、一般的にマレイミド化合物の光ラジカル反応は進行し難く、仮にマレイミド単体のラジカル重合や二量化反応が進行しても、その反応性は非常に低い。しかし、ビスマレイミド化合物（A）は、式（1）で表される構成単位を含むので、光透過性に非常に優れる。そのため、光硬化開始剤まで十分に光が届き、マレイミドの光ラジカル反応が効率的に起き、ビスマレイミド化合物（A）は、後述の樹脂又は化合物（B）、及び光硬化開始剤（C）と共に、種々の活性エネルギー線を用いて光硬化させることができる。

[0033] 本実施形態において、ビスマレイミド化合物（A）は、1質量%で含まれるクロロホルム溶液を調製し、波長365nm（i線）を含む活性エネルギー線を用いて、ビスマレイミド化合物（A）が1質量%で含まれるクロロホルム溶液の透過率を測定した場合においては、その透過率は5%以上と、非常に優れた光透過性を示す。また、波長405nm（h線）を含む活性エネルギー線（光線）を用いて、ビスマレイミド化合物（A）が1質量%で含まれるクロロホルム溶液の透過率を測定した場合においては、その透過率が5%以上と、非常に優れた光透過性を示す。それゆえ、例えば、直接描画露光法を用いて高密度で高精細な配線形成（パターン）を有するプリント配線板を製造するに際し、波長405nm（h線）を含む活性エネルギー線を用いた場合でも、マレイミドの光ラジカル反応が効率的に起こる。波長365nm（i線）における透過率は、より優れた光透過性を示す点から、8%以上であることが好ましく、10%以上であることがより好ましい。波長405nm（h線）における透過率は、より高密度で高精細な配線形成（パターン）を有するプリント配線板を製造する点から、8%以上であることが好ましく、10%以上であることがより好ましい。波長365nm（i線）における透過率、及び波長405nm（h線）における透過率において、それぞれ

の上限は、例えば、99.9%以下である。

[0034] 通常、光硬化開始剤は、長波長の光線を用いると吸光度が低くなる傾向にある。例えば、波長405nm（h線）を含む活性エネルギー線を用いる場合には、この波長の光は比較的長波長であるため、通常的光硬化開始剤では吸収せず、この光を好適に吸収してラジカルを発生できる光硬化開始剤を用いなければ、重合は進行しない。それゆえ、後述の光硬化開始剤（C）としては、光硬化開始剤（C）が0.01質量%で含まれるクロロホルム溶液の吸光度を測定した場合において、波長405nm（h線）の光に対して、その吸光度が0.1以上と、非常に優れた吸収性を示す光硬化開始剤を用いることが好ましい。

[0035] 前記ビスマレイミド化合物（A）は、前記したように光透過性に優れるため、例えば、波長365nmを含む活性エネルギー線、又は波長405nmを含む活性エネルギー線を用いた場合でも、光が光硬化開始剤まで十分に届き、光硬化開始剤から発生したラジカルを用いたラジカル反応が進行し、ビスマレイミド化合物（A）が多く配合されている組成物においても光硬化が可能となる。それゆえ、本実施形態の樹脂組成物は、光硬化性に優れる。

一方、ビスマレイミド化合物（A）は、光硬化しても剛直なイミド環を有することから、高い耐熱性及び熱安定性を有するが、ビスマレイミド化合物を光硬化した硬化物を、露光工程終了後、又は現像工程終了後に行うポストバーク工程などにおいて加熱により更に硬化する際にシワが生じる。そのため、ビスマレイミド化合物（A）を単独重合して得られる硬化物は、多層プリント配線板の用途には不適である。しかし、ビスマレイミド化合物（A）を、後述の樹脂又は化合物（B）と光硬化開始剤（C）と共に配合することで、優れた光硬化性及び絶縁信頼性を有しながら、より高い耐熱性及び熱安定性を有する。それゆえ、本実施形態の樹脂組成物から得られる硬化物は、耐熱性、熱安定性、及び絶縁信頼性に優れ、本実施形態によれば、多層プリント配線板及び半導体装置における、保護膜、及び絶縁層を好適に形成することができる。

[0036] 前記ビスマレイミド化合物（A）は、好適な粘度が得られ、ワニスの粘度上昇が抑制できる点から、質量平均分子量が、100～6000であることが好ましく、300～5500であることがより好ましい。なお、「質量平均分子量」とは、ゲル浸透クロマトグラフィー（GPC）法による、ポリスチレンスタンダード換算の質量平均分子量を意味する。

[0037] 次いで、ビスマレイミド化合物（A）の構造について説明する。

ビスマレイミド化合物（A）の式（1）中、 R_1 は、炭素数1～16の直鎖状若しくは分岐状のアルキレン基、又は炭素数2～16の直鎖状若しくは分岐状のアルケニレン基を示す。 R_1 としては、好適な粘度が得られ、ワニスの粘度上昇が制御できる点から、直鎖状若しくは分岐状のアルキレン基であることが好ましく、直鎖状のアルキレン基であることがより好ましい。

アルキレン基の炭素数としては、より好適な粘度が得られ、ワニスの粘度上昇をより制御できる点から、2～14であることが好ましく、4～12であることがより好ましい。

直鎖状若しくは分岐状のアルキレン基としては、例えば、メチレン基、エチレン基、プロピレン基、2,2-ジメチルプロピレン基、ブチレン基、ペンチレン基、ヘキシレン基、ヘプチレン基、オクチレン基、ノニレン基、デシレン基、ドデシレン基、ウンデシレン基、トリデシレン基、テトラデシレン基、ペンタデシレン基、ヘキサデシレン基、ネオペンチレン基、ジメチルブチレン基、メチルヘキシレン基、エチルヘキシレン基、ジメチルヘキシレン基、トリメチルヘキシレン基、メチルヘプチレン基、ジメチルヘプチレン基、トリメチルヘプチレン基、テトラメチルヘプチレン基、エチルヘプチレン基、メチルオクチレン基、メチルノニレン基、メチルデシレン基、メチルドデシレン基、メチルウンデシレン基、メチルトリデシレン基、メチルテトラデシレン基、及びメチルペンタデシレン基、が挙げられる。

アルケニレン基の炭素数としては、より好適な粘度が得られ、ワニスの粘度上昇をより制御できる点から、2～14であることが好ましく、4～12であることがより好ましい。

直鎖状若しくは分岐状のアルケニレン基としては、例えば、ビニレン基、1-メチルビニレン基、アリレン基、プロペニレン基、イソプロペニレン基、1-ブテニレン基、2-ブテニレン基、1-ペンテニレン基、2-ペンテニレン基、イソペンテニレン基、シクロペンテニレン基、シクロヘキセニレン基、及びジシクロペンタジエニレン基等が挙げられる。

[0038] 前記式(1)中、 R_2 は、炭素数1~16の直鎖状若しくは分岐状のアルキレン基、又は炭素数2~16の直鎖状若しくは分岐状のアルケニレン基を示す。 R_2 としては、好適な粘度が得られ、ワニスの粘度上昇が制御できる点から、直鎖状若しくは分岐状のアルキレン基であることが好ましく、直鎖状のアルキレン基であることがより好ましい。

[0039] アルキレン基の炭素数としては、より好適な粘度が得られ、ワニスの粘度上昇をより制御できる点から、2~14であることが好ましく、4~12であることがより好ましい。

直鎖状若しくは分岐状のアルキレン基としては、 R_1 が参照できる。

[0040] アルケニレン基の炭素数としては、より好適な粘度が得られ、ワニスの粘度上昇をより制御できる点から、2~14であることが好ましく、4~12であることがより好ましい。

直鎖状若しくは分岐状のアルケニレン基としては、 R_1 が参照できる。

[0041] 前記式(1)において、 R_1 と、 R_2 とは、同一であっても異なってもよいが、ビスマレイミド化合物(A)をより容易に合成できる点から、同一であることが好ましい。

[0042] 前記式(1)中、 R_3 は、各々独立に、水素原子、炭素数1~16の直鎖状若しくは分岐状のアルキル基、又は炭素数2~16の直鎖状若しくは分岐状のアルケニル基を示す。 R_3 は、好適な粘度が得られ、ワニスの粘度上昇が制御できる点から、各々独立に、水素原子、又は炭素数1~16の直鎖状若しくは分岐状のアルキル基であることが好ましく、 R_3 のうち、1~4つの基(R_3)が炭素数1~16の直鎖状若しくは分岐状のアルキル基であり、残りの基(R_3)が水素原子であることがより好ましく、 R_3 のうち、1~3つの基(

R₃) が炭素数 1 ~ 16 の直鎖状若しくは分岐状のアルキル基であり、残りの基 (R₃) が水素原子であることが更に好ましい。

アルキル基の炭素数としては、より好適な粘度が得られ、ワニスの粘度上昇がより制御できる点から、2 ~ 14 であることが好ましく、4 ~ 12 であることがより好ましい。

直鎖状若しくは分岐状のアルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、*n*-プロピル基、イソプロピル基、1-エチルプロピル基、*n*-ブチル基、2-ブチル基、イソブチル基、*tert*-ブチル基、*n*-ペンチル基、2-ペンチル基、*tert*-ペンチル基、2-メチルブチル基、3-メチルブチル基、2, 2-ジメチルプロピル基、*n*-ヘキシル基、2-ヘキシル基、3-ヘキシル基、*n*-ヘプチル基、*n*-オクチル基、2-メチルペンチル基、3-メチルペンチル基、4-メチルペンチル基、2-メチルペンタン-3-イル基、及び *n*-ノニル基が挙げられる。

アルケニル基の炭素数としては、より好適な粘度が得られ、ワニスの粘度上昇がより制御できる点から、2 ~ 14 であることが好ましく、4 ~ 12 であることがより好ましい。

直鎖状若しくは分岐状のアルケニル基としては、例えば、ビニル基、アリル基、4-ペンテニル基、イソプロペニル基、イソペンテニル基、2-ヘプテニル基、2-オクテニル基、及び 2-ノネニル基が挙げられる。

[0043] 前記式 (1) 中、R₄ は、各々独立に、水素原子、炭素数 1 ~ 6 の直鎖状若しくは分岐状のアルキル基、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、又は炭素数 1 ~ 6 の直鎖状若しくは分岐状のアルコキシ基を示す。R₄ としては、誘電特性の点から水素原子、炭素数 1 ~ 6 の直鎖状若しくは分岐状のアルキル基が好ましい。

[0044] アルキル基の炭素数としては、より好適な粘度が得られる点から炭素数 1 ~ 6 であることが好ましく、1 ~ 3 であることがより好ましい。

直鎖状若しくは分岐状のアルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、*n*-プロピル基、イソプロピル基が挙げられる。

[0045] ハロゲン原子としては、例えば、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、及びヨウ素原子が挙げられる。

[0046] アルコキシ基炭素数としては、より好適な粘度が得られる点から素数 1～6 であることが好ましく、1～3 であることがより好ましい。

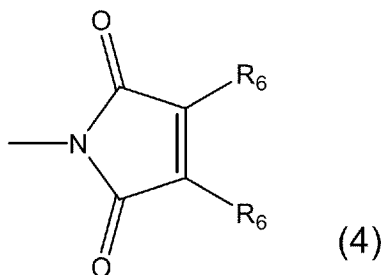
直鎖状若しくは分枝状のアルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、*n*-プロポキシ基、イソプロポキシ基が挙げられる。

[0047] 前記式 (1) 中、 n_1 は、各々独立に、1～4 の整数を示す。 n_2 は、各々独立に、1～4 の整数を示す

[0048] 前記ビスマレイミド化合物 (A) は、分子鎖の両末端にマレイミド基を有する。本実施形態において、両末端とは、ビスマレイミド化合物 (A) の分子鎖において両方の末端を意味し、例えば、式 (1) で表される構造単位が、ビスマレイミド化合物 (A) の分子鎖の末端にある場合には、マレイミド基は、 R_1 の分子鎖の末端に有するか、マレイミド環の N 原子における分子鎖の末端に有するか、又は両方の末端に有することを意味する。ビスマレイミド化合物 (A) は、分子鎖の両末端以外に、マレイミド基を有していてもよい。

本実施形態において、マレイミド基は、式 (4) で表され、N 原子が前記式 (1) の分子鎖に結合している。また、前記式 (1) に結合されるマレイミド基は、全て同一であっても異なってもよいが、分子鎖の両末端のマレイミド基は同一であることが好ましい。

[0049] [化5]



[0050] 前記式 (4) 中、 R_6 は、各々独立に、水素原子、又は炭素数 1～4 の直鎖状若しくは分岐状のアルキル基を示す。 R_6 は、好適に光硬化する点から、両

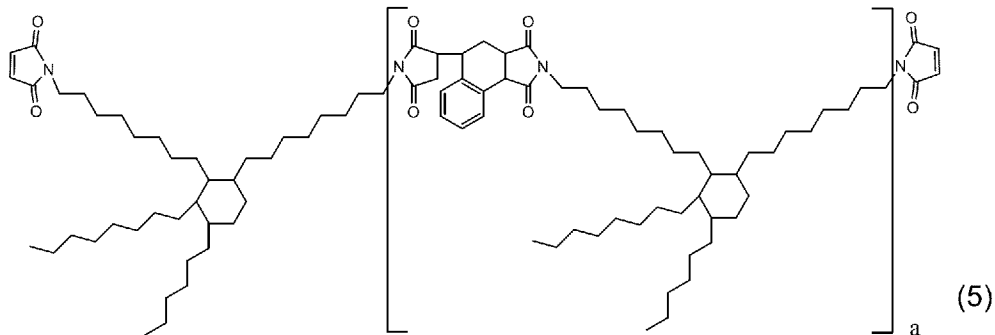
方ともに水素原子であることが好ましい。

アルキル基の炭素数としては、好適に光硬化する点から、1～3であることが好ましく、1～2であることがより好ましい。

直鎖状若しくは分岐状のアルキル基としては、 R_3 が参照できる。

[0051] 該ビスマレイミド化合物（A）としては、例えば、式（5）で表されるビスマレイミド化合物が挙げられる。これらは、1種単独又は2種以上を適宜混合して使用することも可能である。

[0052] [化6]



[0053] 前記式（5）中、 a は、1～10の整数を示す。 a は、より好適な粘度が得られ、ワニスの粘度上昇がより制御できる点から、1～6の整数であることが好ましい。

[0054] 本実施形態の樹脂組成物において、前記ビスマレイミド化合物（A）の含有量は、ビスマレイミド化合物を主成分とした硬化物を得ることが可能となり、光硬化性、耐熱性及び誘電特性をバランスよく向上させることができるという観点から、ビスマレイミド化合物（A）、後述の樹脂又は化合物（B）及び後述の光硬化開始剤（C）の合計100質量部に対して、5～99.4質量部であることが好ましく、8～98質量部であることがより好ましく、13～93質量部であることが更に好ましい。

[0055] 前記ビスマレイミド化合物（A）は、1種単独又は2種以上を適宜混合して使用することも可能である。

[0056] （ビスマレイミド化合物（A）の製造方法）

前記ビスマレイミド化合物（A）は、公知の方法により製造することがで

きる。例えば、4-(2,5-ジオキソテトラヒドロフラン-3-イル)-1,2,3,4-テトラヒドロナフタレン-1,2-ジカルボン酸無水物と、ダイマージアミン等を含むジアミンを含むモノマーと、無水マレイミド酸等のマレイミド化合物とを、通常80~250℃程度、好ましくは100~200℃程度の温度において、通常0.5~50時間程度、好ましくは1~20時間程度、重付加反応させて重付加物を得る、その後、通常60~120℃程度、好ましくは80~100℃程度の温度において、通常0.1~2時間程度、好ましくは0.1~0.5時間程度、重付加物をイミド化反応、すなわち、脱水閉環反応させることで、ビスマレイミド化合物(A)を得ることができる。

[0057] ダイマージアミンは、例えば、ダイマー酸の還元的アミノ化反応によって得られ、アミノ化反応は、例えば、アンモニア及び触媒を使用する還元法等、公知の方法(例えば、特開平9-12712号公報に記載の方法)によって行うことができる。ダイマー酸とは、不飽和脂肪酸が分子間重合反応等によって二量化して得られる二塩基酸である。合成条件及び精製条件にもよるが、通常はダイマー酸の他、モノマー酸やトリマー酸等も少量含まれる。反応後には得られた分子内に二重結合が残存するが、本実施形態では、水素添加反応により、分子内に存在する二重結合が還元されて飽和二塩基酸となったものもダイマー酸に含める。ダイマー酸は、例えば、ルイス酸及びブレンステッド酸を触媒として用いて、不飽和脂肪酸の重合を行うことによって得られる。ダイマー酸は、公知の方法(例えば、特開平9-12712号公報に記載の方法)によって製造することができる。不飽和脂肪酸としては、例えば、クロトン酸、ミリストレイン酸、パルミトレイン酸、オレイン酸、エライジン酸、バクセン酸、ガドレイン酸、エイコセン酸、エルカ酸、ネルボン酸、リノール酸、ピノレン酸、エレオステアリン酸、ミード酸、ジホモγ-リノレン酸、エイコサトリエン酸、ステアリドン酸、アラキドン酸、エイコサテトラエン酸、アドレン酸、ボセオペンタエン酸、オズボンド酸、イワシ酸、テトラコサペンタエン酸、ドコサヘキサエン酸、及びニシン酸が挙

げられる。不飽和脂肪酸の炭素数は、通常4～24であり、好ましくは14～20である。

[0058] ビスマレイミド化合物(A)の製造において、ジアミンを含むモノマーは、予め、例えば、アルゴン、窒素等の不活性雰囲気中において、有機溶媒中に溶解又はスラリー状に分散させて、ジアミンを含むモノマー溶液とすることが好ましい。そして、4-(2,5-ジオキソテトラヒドロフラン-3-イル)-1,2,3,4-テトラヒドロナフタレン-1,2-ジカルボン酸無水物は、有機溶媒に溶解又はスラリー状に分散させた後、あるいは固体の状態で、上記ジアミンを含むモノマー溶液中に添加することが好ましい。

4-(2,5-ジオキソテトラヒドロフラン-3-イル)-1,2,3,4-テトラヒドロナフタレン-1,2-ジカルボン酸無水物のモル数と、ジアミンを含むモノマー及びマレイミド化合物との全量のモル数とを調整することで、任意のビスマレイミド化合物(A)を得ることができる。

[0059] 重付加反応及びイミド化反応に際しては、種々公知の溶媒を使用することができる。溶媒としては、例えば、N,N-ジメチルホルムアミド、N,N-ジメチルアセトアミド、及びN-メチル-2-ピロリドン等のアミド類；アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノン、及びイソホロン等のケトン類； γ -ブチロラクトン、 γ -バレロラクトン、 δ -バレロラクトン、 γ -カプロラクトン、 ϵ -カプロラクトン、 α -メチル- γ -ブチロラクトン、乳酸エチル、酢酸メチル、酢酸エチル、及び酢酸ブチル等のエステル類；メタノール、エタノール、及びプロパノール等の炭素数1～10の脂肪族アルコール類；フェノール、及びクレゾール等の芳香族基含有フェノール類；ベンジルアルコール等の芳香族基含有アルコール類；エチレングリコール、及びプロピレングリコール等のグリコール類、又はそれらのグリコール類と、メタノール、エタノール、ブタノール、ヘキサノール、オクタノール、ベンジルアルコール、フェノール、及びクレゾール等とのモノエーテルもしくはジエーテル、又はこれらのモノエーテルのエステル類等のグリコールエーテル類；ジオキサン、及びテトラヒドロフラン

等のエーテル類；エチレンカーボネート、及びプロピレンカーボネート等の環状カーボネート類；脂肪族及びトルエン、及びキシレン等の芳香族炭化水素類；ジメチルスルホキシド等の非プロトン性極性溶媒が挙げられる。これらの溶媒は、必要に応じて、1種類を単独で又は2種類以上を組み合わせる用いることができる。

[0060] また、イミド化反応においては、触媒を用いることが好ましい。触媒としては、例えば、3級アミン、及び脱水触媒を用いることができる。3級アミンとしては、複素環式の3級アミンが好ましく、例えば、ピリジン、ピコリン、キノリン、及びイソキノリンなどを挙げられる。脱水触媒としては、例えば、無水酢酸、プロピオン酸無水物、*n*-酪酸無水物、安息香酸無水物、及びトリフルオロ酢酸無水物等が挙げられる。

触媒の添加量は、例えば、イミド化剤を、アミド基に対して、0.5～5.0倍モル当量程度、脱水触媒を、アミド基に対して、0.5～10.0倍モル当量とすることが好ましい。

[0061] イミド化反応が完結した後、この溶液をビスマレイミド化合物（A）溶液として使用してもよいし、反応溶媒中に、貧溶媒を投入し、ビスマレイミド化合物（A）を固形物としてもよい。貧溶媒としては、例えば、水、メチルアルコール、エチルアルコール、2-プロピルアルコール、エチレングリコール、トリエチレングリコール、2-ブチルアルコール、2-ペンチルアルコール、2-ヘキシルアルコール、シクロペンチルアルコール、シクロヘキシルアルコール、フェノール、*t*-ブチルアルコールなどが挙げられる。

[0062] [樹脂又は化合物（B）]

本実施形態の樹脂組成物には、ビスマレイミド化合物（A）以外のマレイミド化合物、シアン酸エステル化合物、ベンゾオキサジン化合物、エポキシ樹脂、カルボジイミド化合物、及びエチレン性不飽和基を有する化合物からなる群より選択される少なくとも1種以上の樹脂又は化合物（B）（成分（B）とも称す）を含む。これらの樹脂又は化合物（B）は、得られる硬化物の物性及び用途に応じて、1種単独又は2種以上を適宜混合して使用するこ

とも可能である。

本実施形態において、ビスマレイミド化合物（A）及び後述の光硬化開始剤と共に、樹脂又は化合物（B）を用いると、光硬化性、耐熱性及び熱安定性に優れる。この理由は定かではないが、本発明者らは、ビスマレイミド化合物（A）が有する光硬化性及び絶縁信頼性と、樹脂又は化合物（B）が有する耐熱性及び熱安定性とを両立することが可能であるためと推定している。また、得られる硬化物には、ビスマレイミド化合物（A）と、樹脂又は化合物（B）とが有する種々の物性を付与することも可能となる。ビスマレイミド化合物（A）は、光透過性に非常に優れるため、樹脂又は化合物（B）を用いても、光硬化開始剤まで十分に光が届き、マレイミドの光ラジカル反応が効率的に起き、種々の活性エネルギー線を用いて光硬化させることができる。そのため、例えば、波長365nmを含む活性エネルギー線、又は波長405nmを含む活性エネルギー線を用いても、光が光硬化開始剤まで十分に届き、光硬化開始剤から発生したラジカルを用いたラジカル反応が進行し、樹脂又は化合物（B）が配合されている組成物においても光硬化が可能となる。

[0063] 樹脂又は化合物（B）は、ビスマレイミド化合物（A）及び光硬化開始剤（C）と共に、種々の活性エネルギー線を用いて光硬化させて硬化物を得ることができる。

本実施形態において、樹脂又は化合物（B）は、それぞれ、1質量%で含まれるN-メチルピロリドン溶液を調製し、波長365nm（i線）を含む活性エネルギー線を用いて、カルボキシ基を1つ以上含む化合物（B）が1質量%で含まれるN-メチルピロリドン溶液の透過率を測定した場合においては、その透過率は5%以上であることが好ましい。該樹脂又は化合物（B）は、非常に優れた光透過性を示す。また、波長405nm（h線）を含む活性エネルギー線を用いて、それぞれ、樹脂又は化合物（B）が1質量%で含まれるN-メチルピロリドン溶液の透過率を測定した場合においては、その透過率が5%以上であることが好ましく、この場合においても非常に優れ

た光透過性を示す。該樹脂又は化合物（B）を用いると、例えば、直接描画露光法を用いて高密度で高精細な配線形成（パターン）を有するプリント配線板を製造するに際し、波長405nm（h線）を含む活性エネルギー線を用いた場合でも、マレイミドの光ラジカル反応が効率的に起こる。なお、波長365nm（i線）における透過率は、光硬化性により優れる樹脂組成物を得ることができることから、8%以上であることがより好ましく、10%以上であることが更に好ましい。波長405nm（h線）における透過率は、光硬化性により優れる樹脂組成物を得ることができることから、8%以上であることがより好ましく、10%以上であることが更に好ましい。なお、波長365nm（i線）における透過率、及び波長405nm（h線）における透過率において、それぞれの上限は、例えば、99.9%以下である。

[0064] 樹脂又は化合物（B）は、ワニスの粘度上昇が抑制できる観点から、それぞれ、分子量が、100～5,000であることが好ましい。また、樹脂又は化合物（B）は、本発明の効果を奏する限り特に限定されないが、ワニスの粘度上昇が抑制できる観点から、それぞれ、質量平均分子量が、100～50,000であることが好ましい。なお、本実施形態において、「質量平均分子量」とは、ゲル浸透クロマトグラフィー（GPC）法による、ポリスチレンスタンダード換算の質量平均分子量を意味する。

[0065] 樹脂組成物において、樹脂又は化合物（B）の合計の含有量は、ビスマレイミド化合物を主成分とした硬化物を得ることが可能となり、光硬化性を向上させるという観点から、ビスマレイミド化合物（A）、樹脂又は化合物（B）及び後述の光硬化開始剤（C）の合計100質量部に対して、0.5～85質量部であることが好ましく、1～84質量部であることがより好ましく、5～80質量部であることが更に好ましい。

[0066] （ビスマレイミド化合物（A）以外のマレイミド化合物）

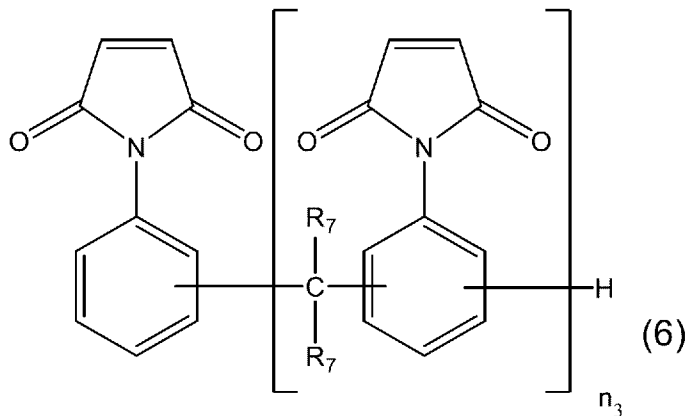
樹脂組成物には、ビスマレイミド化合物（A）以外のマレイミド化合物（B1）（成分（B1）とも称す）を用いることができる。以下にマレイミド化合物（B1）について述べる。

[0067] マレイミド化合物 (B-1) は、マレイミド化合物 (A) 以外であり、分子中に一個以上のマレイミド基を有する化合物であれば、特に限定されない。その具体例としては、N-フェニルマレイミド、N-シクロヘキシルマレイミド、N-ヒドロキシフェニルマレイミド、N-アニリノフェニルマレイミド、N-カルボキシフェニルマレイミド、N-(4-カルボキシ-3-ヒドロキシフェニル)マレイミド、6-マレイミドヘキサン酸、4-マレイミド酪酸、ビス(4-マレイミドフェニル)メタン、2,2-ビス{4-(4-マレイミドフェノキシ)-フェニル}プロパン、4,4-ジフェニルメタンビスマレイミド、ビス(3,5-ジメチル-4-マレイミドフェニル)メタン、ビス(3-エチル-5-メチル-4-マレイミドフェニル)メタン、ビス(3,5-ジエチル-4-マレイミドフェニル)メタン、フェニルメタンマレイミド、o-フェニレンビスマレイミド、m-フェニレンビスマレイミド、p-フェニレンビスマレイミド、o-フェニレンビスシトラコンイミド、m-フェニレンビスシトラコンイミド、p-フェニレンビスシトラコンイミド、2,2-ビス(4-(4-マレイミドフェノキシ)-フェニル)プロパン、3,3-ジメチル-5,5-ジエチル-4,4-ジフェニルメタンビスマレイミド、4-メチル-1,3-フェニレンビスマレイミド、1,2-ビスマレイミドエタン、1,4-ビスマレイミドブタン、1,5-ビスマレイミドペンタン、1,5-ビスマレイミド-2-メチルペンタン、1,6-ビスマレイミドヘキサン、1,6-ビスマレイミド-(2,2,4-トリメチル)ヘキサン、1,8-ビスマレイミド-3,6-ジオキサオクタン、1,11-ビスマレイミド-3,6,9-トリオキサウンデカン、1,3-ビス(マレイミドメチル)シクロヘキサン、1,4-ビス(マレイミドメチル)シクロヘキサン、4,4-ジフェニルエーテルビスマレイミド、4,4-ジフェニルスルホンビスマレイミド、1,3-ビス(3-マレイミドフェノキシ)ベンゼン、1,3-ビス(4-マレイミドフェノキシ)ベンゼン、4,4-ジフェニルメタンビスシトラコンイミド、2,2-ビス[4-(4-シトラコンイミドフェノキシ)フェニル]プロパン、ビス(3,5-ジ

メチル-4-シトラコンイミドフェニル)メタン、ビス(3-エチル-5-メチル-4-シトラコンイミドフェニル)メタン、ビス(3,5-ジエチル-4-シトラコンイミドフェニル)メタン、ポリフェニルメタンマレイミドなどの下記式(6)で表されるマレイミド化合物、下記式(7)で表されるマレイミド化合物、フルオレセイン-5-マレイミド、及びこれらマレイミド化合物のプレポリマー、又はマレイミド化合物とアミン化合物のプレポリマー等が挙げられる。これらのマレイミド化合物(B-1)は、1種単独又は2種以上を適宜混合して使用することも可能である。

[0068] 下記式(6)で表されるマレイミド化合物としては、市販品を利用することもでき、例えば、大和化成工業(株)社製BMI-2300(商品名)が挙げられる。下記式(7)で表されるマレイミド化合物としては、市販品を利用することもでき、例えば、日本化薬(株)社製MIR-3000(商品名)が挙げられる。下記式(8)で表されるマレイミド化合物としては、市販品を利用することもでき、例えば、日本化薬(株)社製MIR-5000(商品名)が挙げられる。

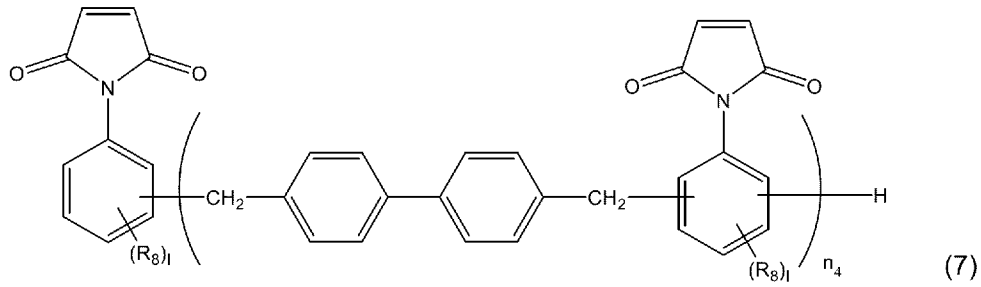
[0069] [化7]



[0070] 前記式(6)中、 R_7 は、各々独立に、水素原子又はメチル基を表す。 n_3 は、1以上の整数を表し、好ましくは1~10の整数を表し、より好ましくは1~5の整数を表す。

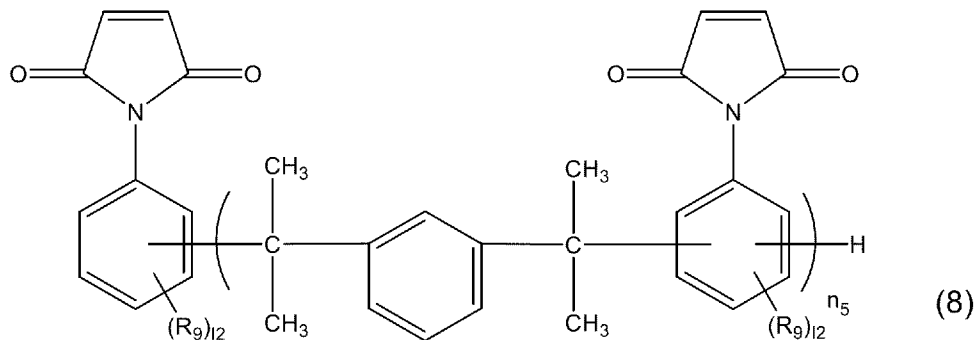
[0071]

[化8]



[0072] 前記式(7)中、 R_8 は、各々独立に、水素原子又はメチル基を表す。 n_4 は、1以上の整数を表し、好ましくは1~5の整数を表す。

[0073] [化9]



[0074] 前記式(8)中、 R_9 は各々独立に、水素原子、炭素数1~5のアルキル基、又はフェニル基を示し、 l_2 は、各々独立に、1~3の整数を示し、 n_5 は、1~10の整数を示す。

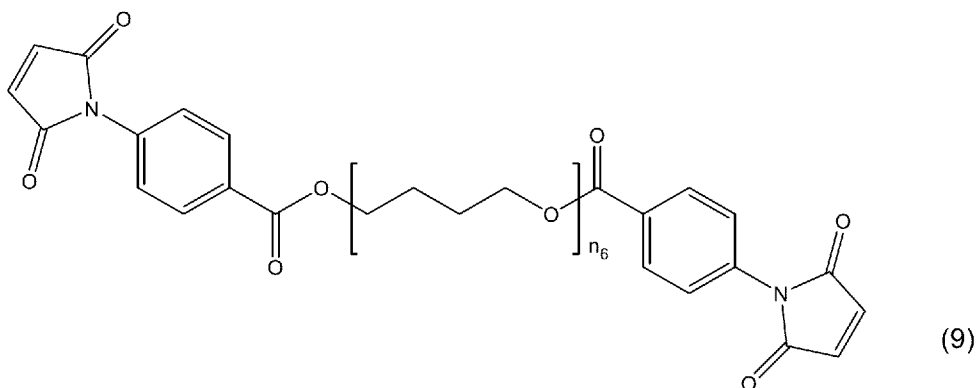
炭素数1~5のアルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、*n*-プロピル基、イソプロピル基、*n*-ブチル基、イソブチル基、*sec*-ブチル基、*t*-ブチル基、*n*-ペンチル基、及びネオペンチル基が挙げられる。

[0075] 本実施形態において、ビスマレイミド化合物(A)の光ラジカル反応を効率的に起こさせるために、マレイミド化合物(B1)が1質量%で含まれるクロロホルム溶液を調製し、波長365nm(i線)を含む活性エネルギー線を用いてこのクロロホルム溶液の透過率を測定した場合に、透過率が5%以上の光透過性を示すことが好ましい。この場合の透過率は、8%以上であることがより好ましく、10%以上であることが更に好ましい。

また、ビスマレイミド化合物（A）の光ラジカル反応を効率的に起こさせるために、マレイミド化合物（B1）が1質量%で含まれるクロロホルム溶液を調製し、波長405nm（h線）を含む活性エネルギー線を用いてこのクロロホルム溶液の透過率を測定した場合に、透過率が5%以上の光透過性を示すことが好ましい。該マレイミド化合物（B1）を用いることで、例えば、直接描画露光法を用いて高密度で高精細な配線形成（パターン）を有するプリント配線板を製造するに際し、波長405nm（h線）を含む活性エネルギー線を用いた場合でも、マレイミドの光ラジカル反応が効率的に起こる。光透過率は、光硬化性により優れる樹脂組成物を得ることができることから、8%以上であることがより好ましく、10%以上であることが更に好ましい。

[0076] 該マレイミド化合物（B-1）としては、例えば、下記式（9）で表されるマレイミド化合物、下記式（10）で表されるマレイミド化合物、下記式（17）で表されるマレイミド化合物等の下記式（11）で表されるマレイミド化合物、下記式（12）で表されるマレイミド化合物、下記式（13）で表されるマレイミド化合物、下記式（14）で表されるマレイミド化合物、1,6-ビスマレイミド-（2,2,4-トリメチル）ヘキサン（下記式（14）で表されるマレイミド化合物）、下記式（16）で表されるマレイミド化合物、及びフルオレセイン-5-マレイミドが挙げられる。

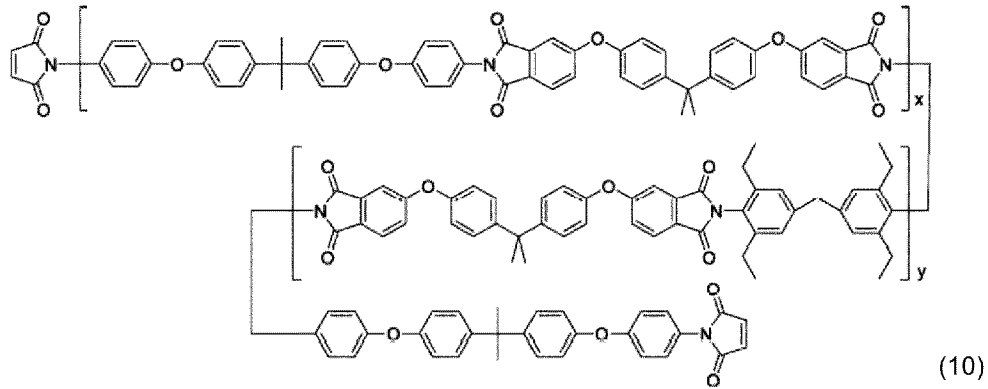
[0077] [化10]



[0078] 前記式（9）中、 n_6 （平均）は1以上であり、好ましくは1~21であり

、より好ましくは、優れた光硬化性を示す観点から、1～16である。

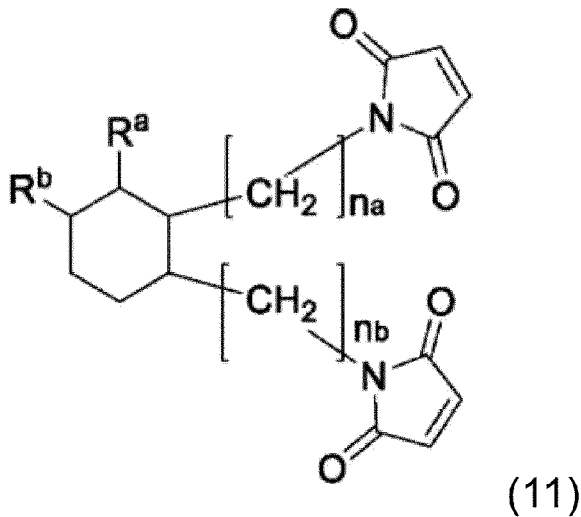
[0079] [化11]



[0080] 前記式(10)中、xの数は、10～35である。

前記式(10)中、yの数は、10～35である。

[0081] [化12]



[0082] 前記式(11)中、 R^a は、炭素数1～16の直鎖状若しくは分岐状のアルキル基、又は炭素数2～16の直鎖状若しくは分岐状のアルケニル基を表す。 R^a としては、直鎖状若しくは分岐状のアルキル基であることが好ましく、優れた光硬化性を示すことから、直鎖状のアルキル基であることがより好ましい。

アルキル基の炭素数としては、優れた光硬化性を示すことから、4～12が好ましい。

アルケニル基の炭素数としては、優れた光硬化性を示すことから、4～12が好ましい。

[0083] 直鎖状若しくは分岐状のアルキル基としては、ビスマレイミド化合物（A）における R_3 が参照できる。これらの中でも、優れた光硬化性を示すことから、 n -ヘプチル基、 n -オクチル基、 n -ノニル基が好ましく、 n -オクチル基がより好ましい。

直鎖状若しくは分岐状のアルケニル基としては、ビスマレイミド化合物（A）における R_3 が参照できる。これらの中でも、優れた光硬化性を示すことから、2-ヘプテニル基、2-オクテニル基、2-ノネニル基が好ましく、2-オクテニル基がより好ましい。

[0084] 前記式（11）中、 R^b は、炭素数1～16の直鎖状若しくは分岐状のアルキル基、又は炭素数2～16の直鎖状若しくは分岐状のアルケニル基を表す。 R^b としては、直鎖状若しくは分岐状のアルキル基であることが好ましく、優れた光硬化性を示すことから、直鎖状のアルキル基であることがより好ましい。

アルキル基の炭素数としては、優れた光硬化性を示すことから、4～12が好ましい。

アルケニル基の炭素数としては、優れた光硬化性を示すことから、4～12が好ましい。

[0085] アルキル基の具体例としては、 R^a におけるアルキル基を参照できる。この中でも、優れた光硬化性を示すことから、 n -ヘプチル基、 n -オクチル基、 n -ノニル基が好ましく、 n -オクチル基がより好ましい。

アルケニル基の具体例としては、 R^a におけるアルケニル基を参照できる。この中でも、優れた光硬化性を示すことから、2-ヘプテニル基、2-オクテニル基、2-ノネニル基が好ましく、2-オクテニル基がより好ましい。

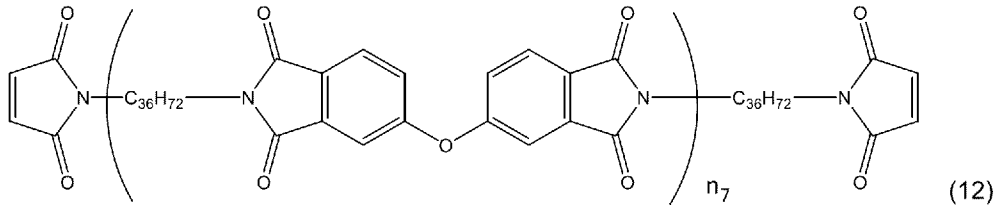
[0086] 前記式（11）中、 n_a の数は1以上であり、好ましくは2～16であり、より好ましくは、優れた光硬化性を示す観点から、3～14である。

[0087] 前記式（11）中、 n_b の数は1以上であり、好ましくは2～16であり、

より好ましくは、優れた光硬化性を示す観点から、3～14である。

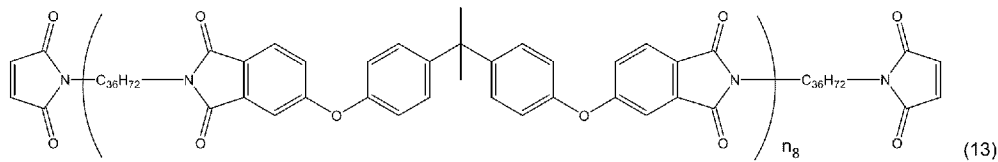
[0088] n_a と n_b の数は同じであっても、異なってもよい。

[0089] [化13]



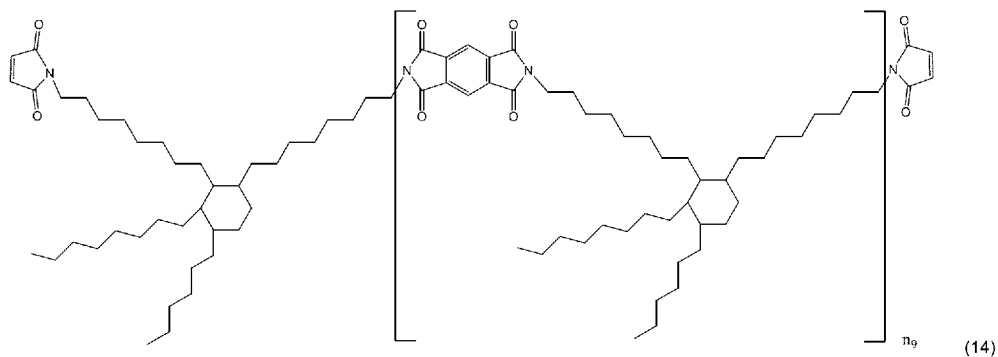
[0090] 前記式(12)中、 n_7 (平均)は0.5以上であり、好ましくは0.8～1.0であり、より好ましくは、優れた光硬化性を示す観点から、1～8である。

[0091] [化14]



[0092] 前記式(13)中、 n_8 は、1以上の整数を表し、好ましくは1～10の整数を表す。

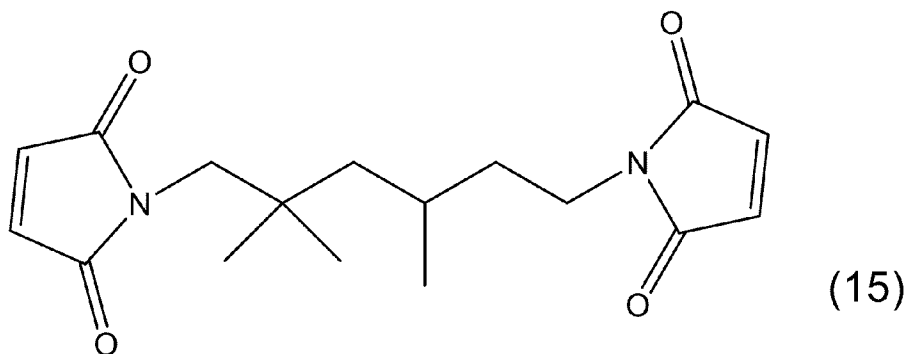
[0093] [化15]



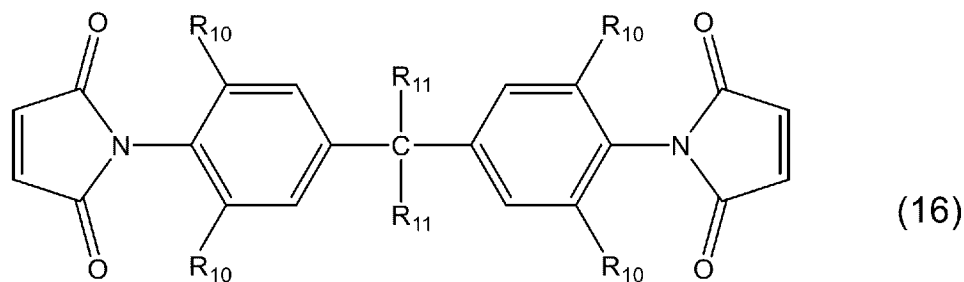
[0094] 前記式(14)中、 n_9 は、1以上の整数を表し、好ましくは1～10の整数を表す。

[0095]

[化16]



[0096] [化17]



[0097] 上記式(16)中、 R_{10} は各々独立に水素原子、メチル基又はエチル基を示し、 R_{11} は各々独立に水素原子又はメチル基を示す。)

[0098] マレイミド化合物(B-1)は、市販品を利用することもできる。

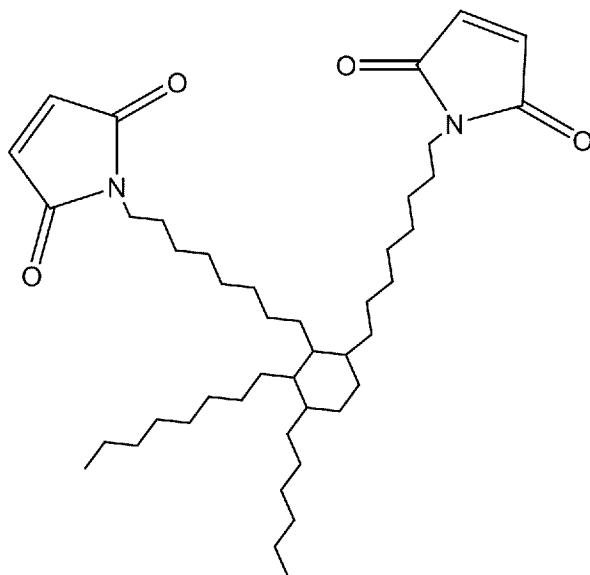
式(9)で表されるマレイミド化合物としては、例えば、ケイ・アイ化成(株)製BMI-1000P(商品名、前記式(9)中の $n_6=13.6$ (平均))、ケイ・アイ化成(株)社製BMI-650P(商品名、前記式(9)中の $n_6=8.8$ (平均))、ケイ・アイ化成(株)社製BMI-250P(商品名、前記式(9)中の $n_6=3\sim 8$ (平均))、ケイ・アイ化成(株)社製CUA-4(商品名、前記式(9)中の $n_6=1$)等が挙げられる。

前記式(10)で表されるマレイミド化合物としては、例えば、Designer Molecules Inc. 製BMI-6100(商品名、前記式(10)中の $x=18$ 、 $y=18$)等が挙げられる。

前記式(11)で表されるマレイミド化合物としては、例えば、Designer Molecules Inc. 製BMI-689(商品名、下記

式(17)、官能基当量：346g/eq.)等が挙げられる。

[0099] [化18]



(17)

[0100] 前記式(12)で表されるマレイミド化合物としては、例えば、Designer Molecules Inc. 製BMI-1500(商品名、前記式(12)中の $n_7=1, 3$ 、官能基当量：754g/eq.)等が挙げられる。

前記式(13)で表されるマレイミド化合物としては、市販品を利用することもでき、例えば、Designer Molecules Inc. (DMI) 製BMI-1700(商品名)が挙げられる。

前記式(14)で表されるマレイミド化合物としては、市販品を利用することもでき、例えば、Designer Molecules Inc. (DMI) 製BMI-3000(商品名)、Designer Molecules Inc. (DMI) 製BMI-5000(商品名)、Designer Molecules Inc. (DMI) 製BMI-9000(商品名)が挙げられる。

前記式(15)で表されるマレイミド化合物としては、市販品を利用することもでき、例えば、大和化成工業株式会社製BMI-TMH(商品名)が挙げられる。

前記式(16)で表されるマレイミド化合物としては、市販品を利用することもでき、例えば、ケイ・アイ化成(株)製BMI-70(商品名)が挙げられる。

これらのマレイミド化合物(B1)は、1種単独又は2種以上を適宜混合して使用することも可能である。

[0101] 樹脂組成物において、マレイミド化合物(B1)の含有量は、ビスマレイミド化合物(A)、マレイミド化合物(B-1)及び光硬化開始剤(C)の合計100質量部に対して、好ましくは0.5~85質量部であることが好ましい。

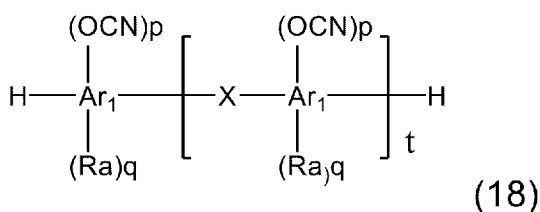
[0102] (シアン酸エステル化合物)

樹脂組成物には、シアン酸エステル化合物(B-2)(成分(B-2)とも称す)を用いることができる。以下にシアン酸エステル化合物(B-2)について述べる。

シアン酸エステル化合物としては、シアナト基(シアン酸エステル基)が少なくとも1個置換された芳香族部分を分子内に有する樹脂であれば特に限定されない。

[0103] 例えば、下記式(18)で表されるものが挙げられる。

[0104] [化19]



[0105] 前記式(18)中、Ar₁は、ベンゼン環、ナフタレン環又は2つのベンゼン環が単結合したものを表す。複数ある場合は互いに同一であっても異なっても良い。Ar₁は、ナフタレン環であることが好ましい。Raは、各々独立に、水素原子、炭素数1~6のアルキル基、炭素数2~6のアルケニル基、炭素数6~12のアリール基、炭素数1~4のアルコキシル基、炭素数1~6のアルキル基と炭素数6~12のアリール基とが結合された基を示す

。R aは、水素原子であることが好ましい。R aにおける芳香環は置換基を有していてもよく、A r₁及びR aにおける置換基は任意の位置を選択できる。pはA r₁に結合するシアナト基の数を示し、各々独立に、1～3の整数であり、1であることが好ましい。qはA r₁に結合するR aの数を示し、A r₁がベンゼン環の時は4-p、ナフタレン環の時は6-p、2つのベンゼン環が単結合したものの時は8-pである。tは平均繰り返し数を示し、0～50の整数であり、好ましくは1～30の整数であり、より好ましくは1～10の整数である。シアン酸エステル化合物は、tが異なる化合物の混合物であってもよい。Xは、複数ある場合は各々独立に、単結合、炭素数1～50の2価の有機基（水素原子がヘテロ原子に置換されていてもよい。）、窒素数1～10の2価の有機基（例えば-N-R-N-（ここでRは有機基を示す。）、カルボニル基（-CO-）、カルボキシ基（-C(=O)O-）、カルボニルジオキサイド基（-OC(=O)O-）、スルホニル基（-SO₂-）、2価の硫黄原子又は2価の酸素原子のいずれかを示す。

[0106] 前記式(18)のR aにおけるアルキル基は、直鎖もしくは分枝の鎖状構造、及び、環状構造（例えばシクロアルキル基等）のいずれを有していてもよい。

また、前記式(18)におけるアルキル基及びR aにおけるアリアル基中の水素原子は、フッ素原子、塩素原子等のハロゲン原子、メトキシ基、フェノキシ基等のアルコキシル基、又はシアノ基等で置換されていてもよい。

[0107] アルキル基の具体例としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、tert-ブチル基、n-ペンチル基、1-エチルプロピル基、2,2-ジメチルプロピル基、シクロペンチル基、ヘキシル基、シクロヘキシル基、及びトリフルオロメチル基等が挙げられる。

アルケニル基の具体例としては、ビニル基、(メタ)アリル基、イソプロペニル基、1-プロペニル基、2-ブテニル基、3-ブテニル基、1,3-ブタンジエニル基、2-メチル-2-プロペニル、2-ペンテニル基、及び

2-ヘキセニル基等が挙げられる。

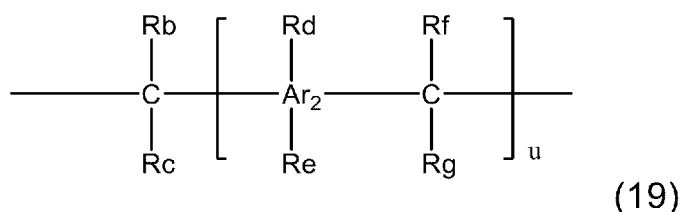
アリアル基の具体例としては、フェニル基、キシリル基、メシチル基、ナフチル基、フェノキシフェニル基、エチルフェニル基、*o*-、*m*-又は*p*-フルオロフェニル基、ジクロロフェニル基、ジシアノフェニル基、トリフルオロフェニル基、メトキシフェニル基、及び*o*-、*m*-又は*p*-トリル基等が挙げられる。更にアルコキシル基としては、例えば、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、イソプロポキシ基、*n*-ブトキシ基、イソブトキシ基、及び*tert*-ブトキシ基等が挙げられる。

[0108] 式(18)のXにおける炭素数1~50の2価の有機基の具体例としては、メチレン基、エチレン基、トリメチレン基、シクロペンチレン基、シクロヘキシレン基、トリメチルシクロヘキシレン基、ビフェニルイルメチレン基、ジメチルメチレン-フェニレン-ジメチルメチレン基、メチレン-フェニレン-メチレン基、フルオレンジイル基、及びフタリドジイル基等が挙げられる。これらの中でも、メチレン-フェニレン-メチレン基が好ましい。2価の有機基中の水素原子は、フッ素原子、塩素原子等のハロゲン原子、メトキシ基、フェノキシ基等のアルコキシル基、シアノ基等で置換されていてもよい。

前記式(18)のXにおける窒素数1~10の2価の有機基としては、イミノ基、ポリイミド基等が挙げられる。

[0109] また、前記式(18)中のXの有機基として、例えば、下記式(19)又は下記式(20)で表される構造であるものが挙げられる。

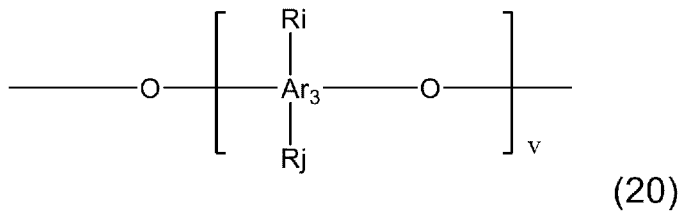
[0110] [化20]



[0111] 前記式(19)中、Ar₂はベンゼンジイル基、ナフタレンジイル基又はビフェニルジイル基を示し、uが2以上の整数の場合、互いに同一であっても

異なってもよい。R b、R c、R f、及びR gは各々独立に、水素原子、炭素数1～6のアルキル基、炭素数6～12のアリール基、トリフルオロメチル基、又はフェノール性ヒドロキシ基を少なくとも1個有するアリール基を示す。R d及び、R eは各々独立に、水素原子、炭素数1～6のアルキル基、炭素数6～12のアリール基、炭素数1～4のアルコキシ基、又はヒドロキシ基のいずれか一種から選択される。uは0～5の整数を示す。

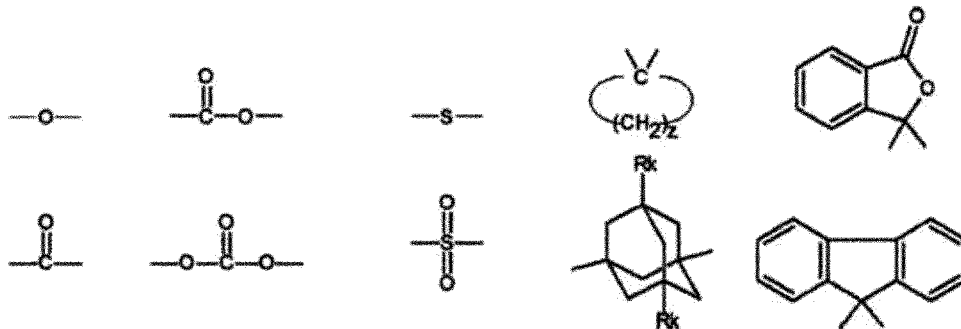
[0112] [化21]



[0113] 前記式(20)中、Ar₃はベンゼンジイル基、ナフタレンジイル基又はビフェニルジイル基を示し、vが2以上の整数の場合、互いに同一であっても異なってもよい。R i、及びR jは各々独立に、水素原子、炭素数1～6のアルキル基、炭素数6～12のアリール基、ベンジル基、炭素数1～4のアルコキシ基、ヒドロキシ基、トリフルオロメチル基、又はシアナト基が少なくとも1個置換されたアリール基を示す。vは0～5の整数を示すが、vが異なる化合物の混合物であってもよい。

[0114] さらに、前記式(18)中のXとしては、下記式で表される2価の基が挙げられる。

[0115] [化22]



[0116] ここで上記式中、zは4～7の整数を示す。R kは各々独立に、水素原子

又は炭素数 1～6 のアルキル基を示す。

前記式 (19) の $A r_2$ 及び前記式 (20) の $A r_3$ の具体例としては、前記式 (19) に示す 2 個の炭素原子、又は前記式 (20) に示す 2 個の酸素原子が、1, 4 位又は 1, 3 位に結合するベンゼンジイル基、2 個の炭素原子又は 2 個の酸素原子が 4, 4' 位、2, 4' 位、2, 2' 位、2, 3' 位、3, 3' 位、又は 3, 4' 位に結合するビフェニルジイル基、及び、2 個の炭素原子又は 2 個の酸素原子が、2, 6 位、1, 5 位、1, 6 位、1, 8 位、1, 3 位、1, 4 位、又は 2, 7 位に結合するナフタレンジイル基が挙げられる。

前記式 (19) の $R b$ 、 $R c$ 、 $R d$ 、 $R e$ 、 $R f$ 及び $R g$ 、並びに前記式 (20) の $R i$ 、 $R j$ におけるアルキル基及びアリアル基は、前記式 (18) におけるものと同義である。

[0117] 前記式 (18) で表されるシアナト置換芳香族化合物の具体例としては、シアナトベンゼン、1-シアナト-2-, 1-シアナト-3-, 又は 1-シアナト-4-メチルベンゼン、1-シアナト-2-, 1-シアナト-3-, 又は 1-シアナト-4-メトキシベンゼン、1-シアナト-2, 3-, 1-シアナト-2, 4-, 1-シアナト-2, 5-, 1-シアナト-2, 6-, 1-シアナト-3, 4- 又は 1-シアナト-3, 5-ジメチルベンゼン、シアナトエチルベンゼン、シアナトブチルベンゼン、シアナトオクチルベンゼン、シアナトノニルベンゼン、2-(4-シアナフェニル)-2-フェニルプロパン (4- α -クミルフェノールのシアネート)、1-シアナト-4-シクロヘキシルベンゼン、1-シアナト-4-ビニルベンゼン、1-シアナト-2- 又は 1-シアナト-3-クロロベンゼン、1-シアナト-2, 6-ジクロロベンゼン、1-シアナト-2-メチル-3-クロロベンゼン、シアナトニトロベンゼン、1-シアナト-4-ニトロ-2-エチルベンゼン、1-シアナト-2-メトキシ-4-アリルベンゼン (オイゲノールのシアネート)、メチル (4-シアナトフェニル) スルフィド、1-シアナト-3-トリフルオロメチルベンゼン、4-シアナトビフェニル、1-シアナト-2-

又は1-シアナト-4-アセチルベンゼン、4-シアナトベンズアルデヒド、4-シアナト安息香酸メチルエステル、4-シアナト安息香酸フェニルエステル、1-シアナト-4-アセトアミノベンゼン、4-シアナトベンゾフェノン、1-シアナト-2,6-ジ-tert-ブチルベンゼン、1,2-ジシアナトベンゼン、1,3-ジシアナトベンゼン、1,4-ジシアナトベンゼン、1,4-ジシアナト-2-tert-ブチルベンゼン、1,4-ジシアナト-2,4-ジメチルベンゼン、1,4-ジシアナト-2,3,4-ジメチルベンゼン、1,3-ジシアナト-2,4,6-トリメチルベンゼン、1,3-ジシアナト-5-メチルベンゼン、1-シアナト又は2-シアナトナフタレン、1-シアナト-4-メトキシナフタレン、2-シアナト-6-メトキシナフタレン、2-シアナト-7-メトキシナフタレン、2,2'-ジシアナト-1,1'-ビナフチル、1,3-, 1,4-, 1,5-, 1,6-, 1,7-, 2,3-, 2,6-又は2,7-ジシアナトナフタレン、2,2'-又は4,4'-ジシアナトビフェニル、4,4'-ジシアナトオクタフルオロビフェニル、2,4'-又は4,4'-ジシアナトジフェニルメタン、ビス(4-シアナト-3,5-ジメチルフェニル)メタン、1,1-ビス(4-シアナトフェニル)エタン、1,1-ビス(4-シアナトフェニル)プロパン、2,2-ビス(4-シアナトフェニル)プロパン、2,2-ビス(4-シアナト-3-メチルフェニル)プロパン、2,2-ビス(2-シアナト-5-ビフェニルイル)プロパン、2,2-ビス(4-シアナトフェニル)ヘキサフルオロプロパン、2,2-ビス(4-シアナト-3,5-ジメチルフェニル)プロパン、1,1-ビス(4-シアナトフェニル)ブタン、1,1-ビス(4-シアナトフェニル)イソブタン、1,1-ビス(4-シアナトフェニル)ペンタン、1,1-ビス(4-シアナトフェニル)-3-メチルブタン、1,1-ビス(4-シアナトフェニル)-2-メチルブタン、1,1-ビス(4-シアナトフェニル)-2,2-ジメチルプロパン、2,2-ビス(4-シアナトフェニル)ブタン、2,2-ビス(4-シアナトフェニル)ペンタン、2,2-ビス(4-シアナトフェニル)ヘキ

サン、2, 2-ビス(4-シアナトフェニル)-3-メチルブタン、2, 2-ビス(4-シアナトフェニル)-4-メチルペンタン、2, 2-ビス(4-シアナトフェニル)-3, 3-ジメチルブタン、3, 3-ビス(4-シアナトフェニル)ヘキサン、3, 3-ビス(4-シアナトフェニル)ヘプタン、3, 3-ビス(4-シアナトフェニル)オクタン、3, 3-ビス(4-シアナトフェニル)-2-メチルペンタン、3, 3-ビス(4-シアナトフェニル)-2-メチルヘキサン、3, 3-ビス(4-シアナトフェニル)-2, 2-ジメチルペンタン、4, 4-ビス(4-シアナトフェニル)-3-メチルヘプタン、3, 3-ビス(4-シアナトフェニル)-2-メチルヘプタン、3, 3-ビス(4-シアナトフェニル)-2, 2-ジメチルヘキサン、3, 3-ビス(4-シアナトフェニル)-2, 4-ジメチルヘキサン、3, 3-ビス(4-シアナトフェニル)-2, 2, 4-トリメチルペンタン、2, 2-ビス(4-シアナトフェニル)-1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロプロパン、ビス(4-シアナトフェニル)フェニルメタン、1, 1-ビス(4-シアナトフェニル)-1-フェニルエタン、ビス(4-シアナトフェニル)ビフェニルメタン、1, 1-ビス(4-シアナトフェニル)シクロペンタン、1, 1-ビス(4-シアナトフェニル)シクロヘキサン、2, 2-ビス(4-シアナト-3-イソプロピルフェニル)プロパン、1, 1-ビス(3-シクロヘキシル-4-シアナトフェニル)シクロヘキサン、ビス(4-シアナトフェニル)ジフェニルメタン、ビス(4-シアナトフェニル)-2, 2-ジクロロエチレン、1, 3-ビス[2-(4-シアナトフェニル)-2-プロピル]ベンゼン、1, 4-ビス[2-(4-シアナトフェニル)-2-プロピル]ベンゼン、1, 1-ビス(4-シアナトフェニル)-3, 3, 5-トリメチルシクロヘキサン、4-[ビス(4-シアナトフェニル)メチル]ビフェニル、4, 4-ジシアナトベンゾフェノン、1, 3-ビス(4-シアナトフェニル)-2-プロペン-1-オン、ビス(4-シアナトフェニル)エーテル、ビス(4-シアナトフェニル)スルフィド、ビス(4-シアナトフェニル)スルホン、4-シアナト安息香酸-4-シアナトフ

エニルエステル（4-シアナトフェニル-4-シアナトベンゾエート）、ビス-（4-シアナトフェニル）カーボネート、1, 3-ビス（4-シアナトフェニル）アダマンタン、1, 3-ビス（4-シアナトフェニル）-5, 7-ジメチルアダマンタン、3, 3-ビス（4-シアナトフェニル）イソベンゾフラン-1（3H）-オン（フェノールフタレインのシアネート）、3, 3-ビス（4-シアナト-3-メチルフェニル）イソベンゾフラン-1（3H）-オン（o-クレゾールフタレインのシアネート）、9, 9'-ビス（4-シアナトフェニル）フルオレン、9, 9-ビス（4-シアナト-3-メチルフェニル）フルオレン、9, 9-ビス（2-シアナト-5-ビフェニルイル）フルオレン、トリス（4-シアナトフェニル）メタン、1, 1, 1-トリス（4-シアナトフェニル）エタン、1, 1, 3-トリス（4-シアナトフェニル）プロパン、 α , α , α' -トリス（4-シアナトフェニル）-1-エチル-4-イソプロピルベンゼン、1, 1, 2, 2-テトラキス（4-シアナトフェニル）エタン、テトラキス（4-シアナトフェニル）メタン、2, 4, 6-トリス（N-メチル-4-シアナトアニリノ）-1, 3, 5-トリアジン、2, 4-ビス（N-メチル-4-シアナトアニリノ）-6-（N-メチルアニリノ）-1, 3, 5-トリアジン、ビス（N-4-シアナト-2-メチルフェニル）-4, 4'-オキシジフタルイミド、ビス（N-3-シアナト-4-メチルフェニル）-4, 4'-オキシジフタルイミド、ビス（N-4-シアナトフェニル）-4, 4'-オキシジフタルイミド、ビス（N-4-シアナト-2-メチルフェニル）-4, 4'-（ヘキサフルオロイソプロピリデン）ジフタルイミド、トリス（3, 5-ジメチル-4-シアナトベンジル）イソシアヌレート、2-フェニル-3, 3-ビス（4-シアナトフェニル）フタルイミジン、2-（4-メチルフェニル）-3, 3-ビス（4-シアナトフェニル）フタルイミジン、2-フェニル-3, 3-ビス（4-シアナト-3-メチルフェニル）フタルイミジン、1-メチル-3, 3-ビス（4-シアナトフェニル）インドリン-2-オン、2-フェニル-3, 3-ビス（4-シアナトフェニル）インドリン-2-オン、及び α -

ナフトールアラルキル型シアン酸エステル樹脂が挙げられる。これらの中でも、硬化物の耐熱性が向上するとの理由から、下記式（28）で表される α -ナフトールアラルキル型シアン酸エステル樹脂（後述の式（28）において、 n_{18} が、1～4のものが含まれる）が好ましい。

[0118] これらのシアン酸エステル化合物は、1種単独又は2種以上を適宜混合して使用することも可能である。

[0119] 上記式（18）で表されるシアン酸エステル化合物の別の具体例としては、フェノールノボラック樹脂及びクレゾールノボラック樹脂（公知の方法により、フェノール、アルキル置換フェノール又はハロゲン置換フェノールと、ホルマリンやパラホルムアルデヒド等のホルムアルデヒド化合物とを、酸性溶液中で反応させたもの）、トリスフェノールノボラック樹脂（ヒドロキシベンズアルデヒドとフェノールとを酸性触媒の存在下に反応させたもの）、フルオレンノボラック樹脂（フルオレノン化合物と9,9-ビス（ヒドロキシアリール）フルオレン類とを酸性触媒の存在下に反応させたもの）、フェノールアラルキル樹脂、クレゾールアラルキル樹脂、ナフトールアラルキル樹脂及びビフェニルアラルキル樹脂（公知の方法により、 $Ar_4-(CH_2Y)_2$ （ Ar_4 はフェニル基を示し、 Y はハロゲン原子を示す。以下、この段落において同様。）で表されるようなビスハロゲノメチル化合物とフェノール化合物とを酸性触媒若しくは無触媒で反応させたもの、 $Ar_4-(CH_2OR)_2$ （ R はアルキル基を示す。）で表されるようなビス（アルコキシメチル）化合物とフェノール化合物とを酸性触媒の存在下に反応させたもの、又は、 $Ar_4-(CH_2OH)_2$ で表されるようなビス（ヒドロキシメチル）化合物とフェノール化合物を酸性触媒の存在下に反応させたもの、あるいは、芳香族アルデヒド化合物とアラルキル化合物とフェノール化合物とを重縮合させたもの）、フェノール変性キシレンホルムアルデヒド樹脂（公知の方法により、キシレンホルムアルデヒド樹脂とフェノール化合物とを酸性触媒の存在下に反応させたもの）、変性ナフタレンホルムアルデヒド樹脂（公知の方法により、ナフタレンホルムアルデヒド樹脂とヒドロキシ置換芳香族化合物を酸性触媒

の存在下に反応させたもの)、フェノール変性ジシクロペンタジエン樹脂、ポリナフチレンエーテル構造を有するフェノール樹脂(公知の方法により、フェノール性ヒドロキシ基を1分子中に2つ以上有する多価ヒドロキシナフタレン化合物を、塩基性触媒の存在下に脱水縮合させたもの)等のフェノール樹脂を、前記と同様の方法によりシアネート化したもの等、並びにこれらのプレポリマー等が挙げられる。これらのシアン酸エステル化合物は、1種単独又は2種以上を適宜混合して使用することも可能である。

[0120] これらのシアン酸エステル化合物の製造方法としては、特に限定されず、公知の方法を用いることができる。かかる製法の例としては、所望の骨格を有するヒドロキシ基含有化合物を入手又は合成し、ヒドロキシ基を公知の手法により修飾してシアネート化する方法が挙げられる。ヒドロキシ基をシアネート化する手法としては、例えば、Ian Hamerton, Chemistry and Technology of Cyanate Ester Resins, Blackie Academic & Professionalに記載の手法が挙げられる。

[0121] これらのシアン酸エステル化合物を用いた硬化物は、ガラス転移温度、低熱膨張性、及びめっき密着性等に優れた特性を有する。

[0122] 樹脂組成物において、シアン酸エステル化合物の含有量は、ビスマレイミド化合物(A)、シアン酸エステル化合物(B-2)及び光硬化開始剤(C)の合計100質量部に対して、0.5~85質量部であることが好ましい。

[0123] (ベンゾオキサジン化合物)

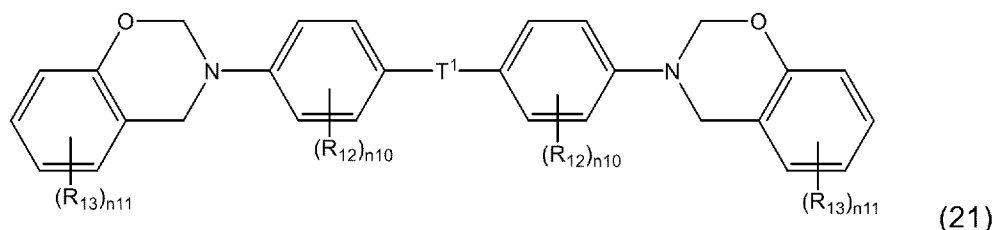
樹脂組成物には、ベンゾオキサジン化合物(B-3)(成分(B-3)とも称す)を用いることができる。以下にベンゾオキサジン化合物(B-3)について述べる。

ベンゾオキサジン化合物(B-3)としては、基本骨格としてオキサジン環を有していれば、一般に公知のものを用いることができる。ベンゾオキサジン化合物には、ナフトオキサジン化合物などの多環オキサジン骨格を有す

る化合物も含まれる。

[0124] ベンゾオキサジン化合物（B-3）としては、良好な光硬化性が得られる点から、式（21）で表される化合物、及び式（22）で表される化合物が好ましい。

[0125] [化23]



[0126] 前記式（21）中、 R_{12} は、各々独立に、水素原子、アリール基、アラルキル基、アルケニル基、アルキル基、又はシクロアルキル基を示す。 n_{10} は、各々独立に、1～4の整数を示す。 R_{13} は、各々独立に、水素原子、アリール基、アラルキル基、アルケニル基、アルキル基、又はシクロアルキル基を示す。 n_{11} は、各々独立に、1～4の整数を示す。 T^1 は、アルキレン基、式（22）で表される基、式「 $-SO_2-$ 」で表される基、「 $-CO-$ 」で表される基、酸素原子、又は単結合を示す。

[0127] R_{12} 及び R_{13} 共に、アリール基としては、炭素原子数6～18のアリール基であることが好ましい。該アリール基として、例えば、フェニル基、ナフチル基、インデニル基、ピフェニル基、及びアントリル基が挙げられる。中でも、フェニル基がより好ましい。これらのアリール基は、炭素原子数1から4の低級アルキル基を1個以上、好ましくは、1～3個の範囲で有していてもよい。そのような低級アルキル基を有するアリール基としては、例えば、トリル基、キシリル基、及びメチルナフチル基などを挙げるができる。

[0128] R_{12} 及び R_{13} 共に、アラルキル基は、ベンジル基、及びフェネチル基であることが好ましい。これらは、そのフェニル基上に炭素原子数1から4の低級アルキル基を1個以上、好ましくは、1～3個の範囲で有していてもよい。

[0129] R_{12} 及び R_{13} 共に、アルケニル基としては、例えば、ビニル基、（メタ）アリル基、プロペニル基、ブテニル基、及びヘキセニル基が挙げられる。これ

らの中でも、ビニル基、アリル基、及びプロペニル基が好ましく、アリル基がより好ましい。

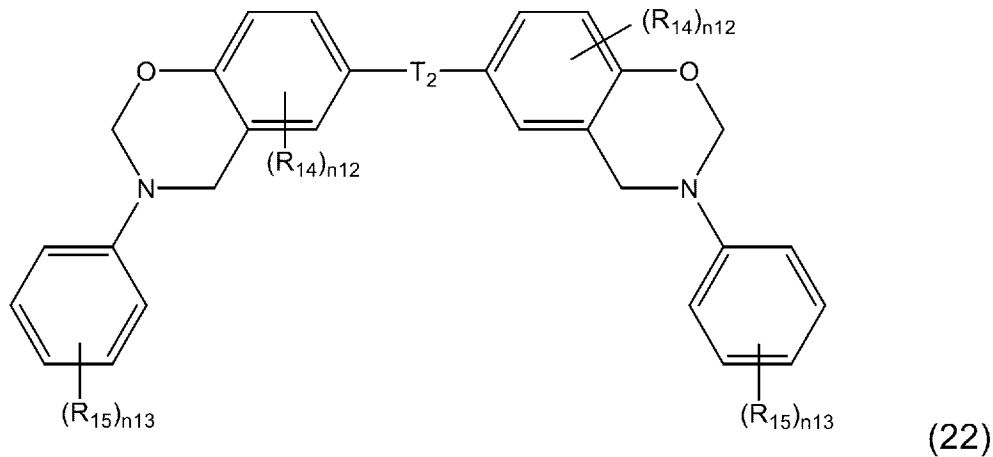
[0130] R_{12} 及び R_{13} 共に、アルキル基としては、炭素原子数1～20のアルキル基が好ましく、より好ましくは炭素原子数1～10のアルキル基である。炭素原子数3以上のアルキル基は、直鎖状でも分岐鎖状でもよい。例えば、メチル基、エチル基、*n*-プロピル基、イソプロピル基、*n*-ブチル基、イソブチル基、*sec*-ブチル基、*t*-ブチル基、*n*-ペンチル基、ネオペンチル基、*n*-ヘキシル基、テキシル基、*n*-ヘプチル基、*n*-オクチル基、*n*-エチルヘキシル基、*n*-ノニル基、及び*n*-デシル基が挙げられる。

[0131] R_{12} 及び R_{13} 共に、シクロアルキル基としては、例えば、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、及びシクロヘプチル基が挙げられる。好ましくは、シクロヘキシル基である。

[0132] T¹におけるアルキレン基としては、直鎖状又は分岐鎖状のアルキレン基が好ましい。直鎖状のアルキレン基としては、例えば、メチレン基、エチレン基、プロピレン基、ブチレン基、ペンチレン基、ヘキシレン基、ヘプチレン基、オクチレン基、ノニレン基、デカニレン基、トリメチレン基、テトラメチレン基、ペンタメチレン基、及びヘキサメチレン基が挙げられる。分岐鎖状のアルキレン基としては、例えば、 $-C(CH_3)_2-$ 、 $-CH(CH_3)-$ 、 $-CH(CH_2CH_3)-$ 、 $-C(CH_3)(CH_2CH_3)-$ 、 $-C(CH_3)(CH_2CH_2CH_3)-$ 、及び $-C(CH_2CH_3)_2-$ のアルキルメチレン基； $-CH(CH_3)CH_2-$ 、 $-CH(CH_3)CH(CH_3)-$ 、 $-C(CH_3)_2CH_2-$ 、 $-CH(CH_2CH_3)CH_2-$ 、及び $-C(CH_2CH_3)_2-CH_2-$ のアルキルエチレン基が挙げられる。

[0133]

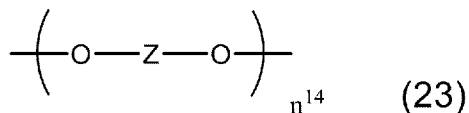
[化24]



[0134] 前記式(22)中、 R_{14} は、各々独立に、水素原子、アリール基、アラルキル基、アルケニル基、アルキル基、又はシクロアルキル基を示す。 n_{12} は、各々独立に、1~3の整数を示す。 R_{15} は、各々独立に、水素原子、アリール基、アラルキル基、アルケニル基、アルキル基、又はシクロアルキル基を示す。 n_{13} は、各々独立に、1~5の整数を示す。 T_2 は、アルキレン基、式(22)で表される基、式「 $-SO_2-$ 」で表される基、「 $-CO-$ 」で表される基、酸素原子、又は単結合を示す。

[0135] R_{14} 及び R_{15} 共に、アリール基、アラルキル基、アルケニル基、アルキル基、及びシクロアルキル基については前記のとおりである。 T_2 におけるアルキレン基については、前記のとおりである。

[0136] [化25]



[0137] 前記式(23)中、 Z は、アルキレン基又は芳香族環を有する炭素数6以上30以下の炭化水素基である。 n_{14} は、0以上5以下の整数を示す。 n_{14} は、1以上3以下の整数であることが好ましく、1又は2であることがより好ましい。

[0138] Z におけるアルキレン基については、前記のとおりである。

[0139] 芳香族環を有する炭素数6以上30以下の炭化水素基としては、例えば、

ベンゼン、ビフェニル、ナフタレン、アントラセン、フルオレン、フェナントレイン、インダセン、ターフェニル、アセナフチレン、及びフェナレンの芳香族性を有する化合物の核から水素原子を2つ除いた2価の基が挙げられる。

[0140] ベンゾオキサジン化合物（B-3）としては、市販品を用いてもよく、例えば、P-d型ベンゾオキサジン（四国化成工業社製、3, 3' -（メチレン-1, 4-ジフェニレン）ビス（3, 4-ジヒドロ-2H-1, 3-ベンゾオキサジン）、式（20）で表される化合物）、F-a型ベンゾオキサジン（四国化成工業社製、2, 2-ビス（3, 4-ジヒドロ-2H-3-フェニル-1, 3-ベンゾオキサジニル）メタン、式（21）で表される化合物）、ビスフェノールA型ベンゾオキサジンBA-BXZ（小西化学工業（株）製、商品名）ビスフェノールF型ベンゾオキサジンBF-BXZ（小西化学工業（株）製、商品名）、ビスフェノールS型ベンゾオキサジンBS-BXZ（小西化学工業（株）製、商品名）、及びフェノールフタレイン型ベンゾオキサジン等が挙げられる。

[0141] これらのベンゾオキサジン化合物（B-3）は、1種単独又は2種以上を適宜混合して使用することも可能である。

ベンゾオキサジン化合物は、良好な耐熱性を有するとの理由から、式（20）で表される化合物、及び式（21）で表される化合物が好ましく、3, 3' -（メチレン-1, 4-ジフェニレン）ビス（3, 4-ジヒドロ-2H-1, 3-ベンゾオキサジン）がより好ましい。

[0142] 樹脂組成物において、ベンゾオキサジン化合物の含有量は、ビスマレイミド化合物（A）、ベンゾオキサジン化合物（B-3）及び光硬化開始剤（C）の合計100質量部に対して、0.5～85質量部であることが好ましい。

[0143] （エポキシ樹脂）

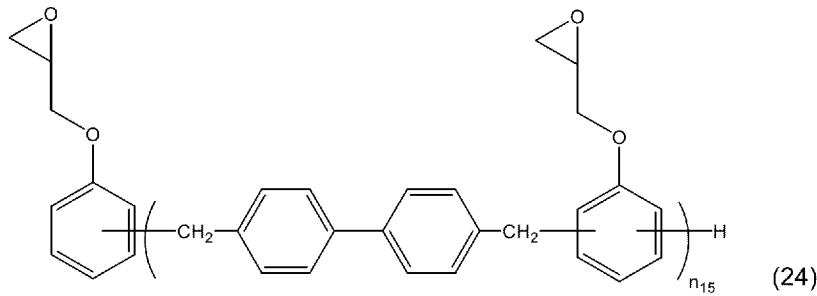
樹脂組成物には、エポキシ樹脂（B-4）（成分（B-4）とも称す）を用いることができる。以下にエポキシ樹脂（B-4）について述べる。

エポキシ樹脂（B-4）としては、一般に公知のものを使用できる。例えば、ビスフェノールA型エポキシ樹脂、ビスフェノールE型エポキシ樹脂、ビスフェノールF型エポキシ樹脂、ビスフェノールS型エポキシ樹脂、ビスフェノールAノボラック型エポキシ樹脂、ビフェニル型エポキシ樹脂、フェノールノボラック型エポキシ樹脂、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂、キシレンノボラック型エポキシ樹脂、多官能フェノール型エポキシ樹脂、ナフタレン型エポキシ樹脂、ナフタレン骨格変性ノボラック型エポキシ樹脂、ナフチレンエーテル型エポキシ樹脂、フェノールアラルキル型エポキシ樹脂、アントラセン型エポキシ樹脂、3官能フェノール型エポキシ樹脂、4官能フェノール型エポキシ樹脂、トリグリシジルイソシアヌレート、グリシジルエステル型エポキシ樹脂、脂環式エポキシ樹脂、ジシクロペンタジエンノボラック型エポキシ樹脂、ビフェニルノボラック型エポキシ樹脂、フェノールアラルキルノボラック型エポキシ樹脂、ナフトールアラルキルノボラック型エポキシ樹脂、アラルキルノボラック型エポキシ樹脂、ナフトールアラルキル型エポキシ樹脂、ジシクロペンタジエン型エポキシ樹脂、ポリオール型エポキシ樹脂、リン含有エポキシ樹脂、グリシジルアミン、ブタジエン等の二重結合をエポキシ化した化合物、水酸基含有シリコーン樹脂類とエピクロルヒドリンとの反応により得られる化合物、及びこれらのハロゲン化物が挙げられる。これらのエポキシ樹脂は、1種単独又は2種以上を適宜混合して使用することも可能である。

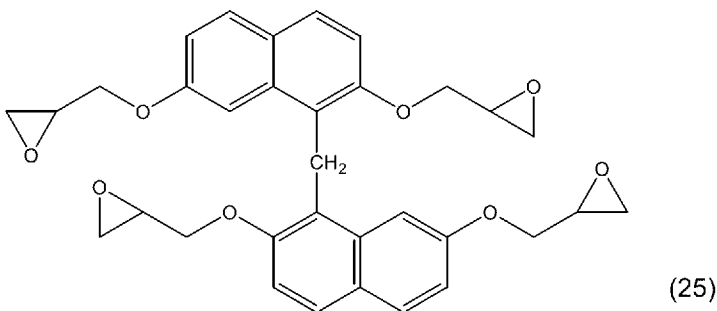
[0144] エポキシ樹脂としては、市販品を利用することもできる。市販品としては、例えば、下記式（24）で表されるエポキシ樹脂（日本化薬（株）製NC-3000FH（商品名）、下記式（24）中、 n_{15} は3~5であり、約4である）、及び下記式（25）で表されるナフタレン型エポキシ樹脂（DIC（株）製HP-4710（商品名））が挙げられる。

[0145]

[化26]



[0146] [化27]



[0147] これらのエポキシ樹脂は、1種単独又は2種以上を適宜混合して使用することも可能である。

エポキシ樹脂は、硬化物の耐熱性に優れるとの理由から、前記式(23)で表されるエポキシ樹脂、及び前記式(24)で表されるエポキシ樹脂が好ましく、前記式(23)で表されるエポキシ樹脂がより好ましい。

[0148] 樹脂組成物において、エポキシ樹脂の含有量は、ビスマレイミド化合物(A)、エポキシ樹脂(B4)及び光硬化開始剤(C)の合計100質量部に対して、0.5～85質量部であることが好ましい。

[0149] (カルボジイミド化合物)

樹脂組成物には、カルボジイミド化合物(B-5)(成分(B-5)とも称す)を用いることができる。以下にカルボジイミド化合物(B-5)について述べる。

カルボジイミド化合物(B-5)としては、少なくとも分子中に1個以上のカルボジイミド基を有していれば、一般に公知のものを使用できる。例え

ば、N, N' -ジシクロヘキシルカルボジイミド、ジシクロヘキシルカルボジイミド、ジイソプロピルカルボジイミド、ジメチルカルボジイミド、ジイソブチルカルボジイミド、ジオクチルカルボジイミド、t-ブチルイソプロピルカルボジイミド、ジフェニルカルボジイミド、ジ-tert-ブチルカルボジイミド、ジ-β-ナフチルカルボジイミド、N, N' -ジ-2, 6-ジイソプロピルフェニルカルボジイミド、2, 6, 2', 6'-テトライソプロピルジフェニルカルボジイミド、環状カルボジイミド、カルボジライト（登録商標）B-01（日清紡ケミカル（株）製）、及びスタバクゾール（登録商標：Rhein Chemie社製）等のポリカルボジイミド等が挙げられる。

[0150] これらのカルボジイミド化合物（B-5）は、1種単独又は2種以上を適宜混合して使用することも可能である。

カルボジイミド化合物は、良好な耐熱性を有し、プリント配線板の絶縁層に用いた場合に導体層と良好な密着性を有するとの理由から、カルボジライト（登録商標）B-01、V-03、V05（以上、商品名、日清紡ケミカル（株）製）が好ましく、カルボジライト（登録商標）B-01（商品名、日清紡ケミカル（株）製）がより好ましい。

[0151] 樹脂組成物において、カルボジイミド化合物の含有量は、樹脂組成物中の樹脂固形分100質量部に対して、0.5～85質量部であることが好ましい。

[0152] （エチレン性不飽和基を有する化合物）

樹脂組成物には、エチレン性不飽和基を有する化合物（B-6）（成分（B-6）とも称す）を用いることができる。以下にエチレン性不飽和基を有する化合物（B-6）について述べる。

エチレン性不飽和基を有する化合物（B-6）としては、1分子中に1個以上のエチレン性不飽和基を有する化合物であれば、一般に公知のものを使用できる。例えば、（メタ）アクリロイル基、及びビニル基等を有する化合物が挙げられる。

[0153] (メタ) アクリロイル基を有する化合物としては、メチル (メタ) アクリレート、エチル (メタ) アクリレート、ブチル (メタ) アクリレート、ラウリル (メタ) アクリレート、ポリエチレングリコール (メタ) アクリレート、ポリエチレングリコール (メタ) アクリレートモノメチルエーテル、フェニルエチル (メタ) アクリレート、イソボルニル (メタ) アクリレート、シクロヘキシル (メタ) アクリレート、ベンジル (メタ) アクリレート、テトラヒドロフルフリル (メタ) アクリレート、ブタンジオールジ (メタ) アクリレート、ヘキサジオールジ (メタ) アクリレート、ネオペンチルグリコールジ (メタ) アクリレート、ノナンジオールジ (メタ) アクリレート、グリコールジ (メタ) アクリレート、ジエチレンジ (メタ) アクリレート、ポリエチレングリコールジ (メタ) アクリレート、トリス (メタ) アクリロイルオキシエチルイソシアヌレート、ポリプロピレングリコールジ (メタ) アクリレート、アジピン酸エポキシジ (メタ) アクリレート、ビスフェノールエチレンオキサジ (メタ) アクリレート、水素化ビスフェノールエチレンオキサジ (メタ) アクリレート、ビスフェノールジ (メタ) アクリレート、 ϵ -カプロラクトン変性ヒドロキシピバリン酸ネオペンチルグリコールジ (メタ) アクリレート、 ϵ -カプロラクトン変性ジペンタエリスリトールヘキサ (メタ) アクリレート、 ϵ -カプロラクトン変性ジペンタエリスリトールポリ (メタ) アクリレート、ジペンタエリスリトールポリ (メタ) アクリレート、トリメチロールプロパントリ (メタ) アクリレート、トリエチロールプロパントリ (メタ) アクリレート、及びそのエチレンオキサジ付加物；ペンタエリスリトールトリ (メタ) アクリレート、及びそのエチレンオキサジ付加物；ペンタエリスリトールテトラ (メタ) アクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサ (メタ) アクリレート、及びそのエチレンオキサジ付加物が挙げられる。

[0154] また、この他にも、(メタ) アクリロイル基とウレタン結合を同一分子内に併せ持つウレタン (メタ) アクリレート類；(メタ) アクリロイル基とエステル結合を同一分子内に併せ持つポリエステル (メタ) アクリレート類；

エポキシ樹脂から誘導され、(メタ)アクリロイル基を併せ持つエポキシ(メタ)アクリレート類;これらの結合が複合的に用いられている反応性オリゴマー等も挙げられる。

[0155] ウレタン(メタ)アクリレート類とは、水酸基含有(メタ)アクリレートとポリイソシアネート、必要に応じて用いられるその他アルコール類との反応物が挙げられる。例えば、ヒドロキシエチル(メタ)アクリレート、ヒドロキシプロピル(メタ)アクリレート、ヒドロキシブチル(メタ)アクリレート等のヒドロキシアルキル(メタ)アクリレート類;グリセリンモノ(メタ)アクリレート、グリセリンジ(メタ)アクリレート等のグリセリン(メタ)アクリレート類;ペンタエリスリトールジ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリトールトリ(メタ)アクリレート、ジペンタエリスリトールペンタ(メタ)アクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサ(メタ)アクリレート等の糖アルコール(メタ)アクリレート類と、トルエンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート、トリメチルヘキサメチレンジイソシアネート、イソホロンジイソシアネート、ノルボルネンジイソシアネート、キシレンジイソシアネート、水添キシレンジイソシアネート、ジシクロヘキサメチレンジイソシアネート、及びそれらのイソシアヌレート、ビュレット反応物等のポリイソシアネート等を反応させた、ウレタン(メタ)アクリレート類が挙げられる。

[0156] ポリエステル(メタ)アクリレート類とは、例えば、カプロラクトン変性2-ヒドロキシエチル(メタ)アクリレート、エチレンオキサイド及び/又はプロピレンオキサイド変性フタル酸(メタ)アクリレート、エチレンオキサイド変性コハク酸(メタ)アクリレート、カプロラクトン変性テトラヒドロフルフリル(メタ)アクリレート等の単官能(ポリ)エステル(メタ)アクリレート類;ヒドロキシピバリン酸エステルネオペンチルグリコールジ(メタ)アクリレート、カプロラクトン変性ヒドロキシピバリン酸エステルネオペンチルグリコールジ(メタ)アクリレート、エピクロルヒドリン変性フタル酸ジ(メタ)アクリレート等のジ(ポリ)エステル(メタ)アクリレー

ト類；トリメチロールプロパン又はグリセリン1モルに1モル以上の ϵ -カプロラクトン、 γ -ブチロラクトン、 δ -バレロラクトン等の環状ラクトン化合物を付加して得たトリオールモノ、ジ又はトリ（メタ）アクリレートが挙げられる。

[0157] ペンタエリスリトール、ジメチロールプロパン、トリメチロールプロパン、又はテトラメチロールプロパン1モルに、1モル以上の ϵ -カプロラクトン、 γ -ブチロラクトン、 δ -バレロラクトン等の環状ラクトン化合物を付加して得たトリオールモノ、ジ、トリ又はテトラ（メタ）アクリレート；ジペンタエリスリトール1モルに1モル以上の ϵ -カプロラクトン、 γ -ブチロラクトン、 δ -バレロラクトン等の環状ラクトン化合物を付加して得たトリオールモノ、若しくはポリ（メタ）アクリレートのトリオール、テトラオール、ペンタオール又はヘキサオール等の多価アルコールモノ（メタ）アクリレート又はポリ（メタ）アクリレートが挙げられる。

[0158] 更に、（ポリ）エチレングリコール、（ポリ）プロピレングリコール、（ポリ）テトラメチレングリコール、（ポリ）ブチレングリコール、3-メチル-1,5-ペンタンジオール、ヘキサジオール等のジオール成分と、マレイン酸、フマル酸、コハク酸、アジピン酸、フタル酸、イソフタル酸、ヘキサヒドロフタル酸、テトラヒドロフタル酸、ダイマー酸、セバチン酸、アゼライン酸、5-ナトリウムスルホイソフタル酸等の多塩基酸、及びこれらの無水物との反応物であるポリエステルポリオールの（メタ）アクリレート；ジオール成分と多塩基酸及びこれらの無水物と ϵ -カプロラクトン、 γ -ブチロラクトン、 δ -バレロラクトン等からなる環状ラクトン変性ポリエステルジオールの（メタ）アクリレート等の多官能（ポリ）エステル（メタ）アクリレート類等を挙げることができる。

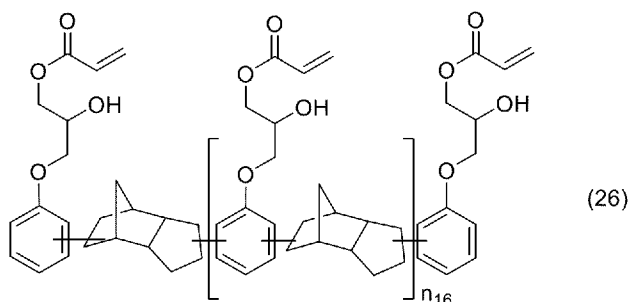
[0159] エポキシ（メタ）アクリレート類とは、エポキシ基を有する化合物と（メタ）アクリル酸とのカルボキシレート化合物である。例えば、フェノールノボラック型エポキシ（メタ）アクリレート、クレゾールノボラック型エポキシ（メタ）アクリレート、トリスヒドロキシフェニルメタン型エポキシ（メ

タ) アクリレート、ジシクロペンタジエンフェノール型エポキシ (メタ) アクリレート、ビスフェノールA型エポキシ (メタ) アクリレート、ビスフェノールF型エポキシ (メタ) アクリレート、ビフェノール型エポキシ (メタ) アクリレート、ビスフェノールAノボラック型エポキシ (メタ) アクリレート、ナフタレン骨格含有エポキシ (メタ) アクリレート、グリオキサール型エポキシ (メタ) アクリレート、複素環式エポキシ (メタ) アクリレート等、及びこれらの酸無水物変性エポキシアクリレート等が挙げられる。

[0160] ビニル基を有する化合物としては、例えば、エチルビニルエーテル、プロピルビニルエーテル、ヒドロキシエチルビニルエーテル、エチレングリコールジビニルエーテル等のビニルエーテル類；スチレン、メチルスチレン、エチルスチレン、ジビニルベンゼン等のスチレン類が挙げられる。その他ビニル化合物としてはトリアリルイソシアヌレート、トリメタアリルイソシアヌレート、及びビスアリルナジイミド等が挙げられる。

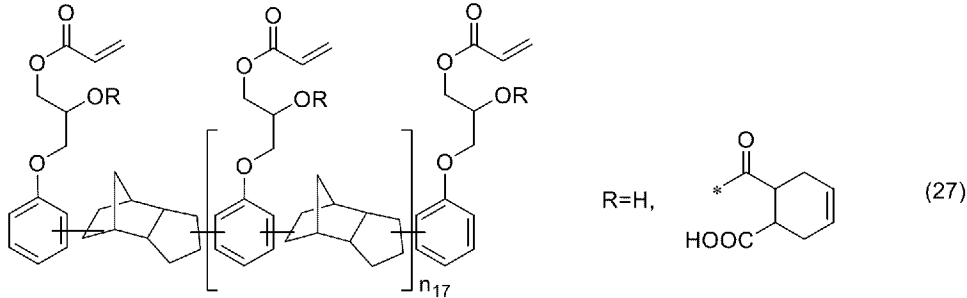
[0161] エチレン性不飽和基を有する化合物としては、市販品を利用することができ、例えば、式 (26) で表される化合物であるジシクロペンタジエンフェノール型エポキシアクリレート (日本化薬 (株) 製 KAYARAD (登録商標) ZX A-101H (商品名))、下記の式 (27) で表される化合物である酸変性ジシクロペンタジエンフェノール型エポキシアクリレート (日本化薬 (株) 製 KAYARAD (登録商標) ZX A-1807H (商品名)、KAYARAD (登録商標) ZX R-1810H (商品名)、KAYARAD (登録商標) ZX R-1816H (商品名)、及び KAYARAD (登録商標) ZX R-1889H (商品名)) が挙げられる。

[0162] [化28]



前記式(26)中、 n_{16} は、0~10の整数を示す。 n_{16} は、より好適な粘度が得られ、ワニスの粘度上昇がより制御できる点から、0~5の整数であることが好ましい。

[0163] [化29]



前記式(27)中、 n_{17} は、0~10の整数を示す。 n_{17} は、より好適な粘度が得られ、ワニスの粘度上昇がより制御できる点から、0~5の整数であることが好ましい。

[0164] これらのエチレン性不飽和基を有する化合物(B-6)は、1種単独又は2種以上を適宜混合して使用することも可能である。

エチレン性不飽和基を有する化合物としては、良好な熱安定性を有するとの理由から、ジシクロペンタジエンフェノール型エポキシアクリレート化合物のプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートが好ましい。

[0165] 樹脂組成物において、エチレン性不飽和基を有する化合物の含有量は、ビスマレイミド化合物(A)、ベンゾオキサジン化合物(B-3)及び光硬化開始剤(C)の合計100質量部に対して、0.5~85質量部であることが好ましい。

[0166] [光硬化開始剤(C)]

本実施形態に係る樹脂組成物には、光硬化開始剤(C)(成分(C)とも称す)を含む。光硬化開始剤(C)は、一般に光硬化性樹脂組成物で用いられる分野で公知のものを使用することができる。光硬化開始剤(C)は、ビスマレイミド化合物(A)、及び樹脂又は化合物(B)と共に、種々の活性エネルギー線を用いて光硬化させるために用いられる。

[0167] 光硬化開始剤(C)としては、例えば、ベンゾイン、ベンゾインメチルエ

ーテル、ベンゾインエチルエーテル、ベンゾインプロピルエーテル、及びベンゾインイソブチルエーテル等のベンゾイン類、過酸化ベンゾイル、ラウロイルパーオキサイド、アセチルパーオキサイド、パラクロロベンゾイルパーオキサイド、及びジ-tert-ブチルジパーオキシフタレート等で例示される有機過酸化物；2, 4, 6-トリメチルベンゾイルジフェニルフォスフィンオキサイド、及びビス(2, 4, 6-トリメチルベンゾイル)フェニルフォスフィンオキサイド等のフォスフィンオキサイド類；アセトフェノン、2, 2-ジエトキシ-2-フェニルアセトフェノン、2, 2-ジエトキシ-2-フェニルアセトフェノン、1, 1-ジクロロアセトフェノン、2-ヒドロキシ-2-メチルフェニルプロパン-1-オン、ジエトキシアセトフェノン、1-ヒドロキシクロヘキシルフェニルケトン、2-メチル-1-[4-(メチルチオ)フェニル]-2-モルフォリノプロパン-1-オン、及び2-ベンジル-2-ジメチルアミノ-1-(4-モルフォリノフェニル)ブタノン-1等のアセトフェノン類；2-エチルアントラキノン、2-tert-ブチルアントラキノン、2-クロロアントラキノン、及び2-アミルアントラキノン等のアントラキノン類；2, 4-ジエチルチオキサントン、2-イソプロピルチオキサントン、及び2-クロロチオキサントン等のチオキサントン類；アセトフェノンジメチルケタール、及びベンジルジメチルケタール等のケタール類；ベンゾフェノン、4-ベンゾイル-4'-メチルジフェニルサルファイド、及び4, 4'-ビスメチルアミノベンゾフェノン等のベンゾフェノン類；1, 2-オクタジオン、1-[4-(フェニルチオ)-2-(O-ベンゾイルオキシム)]、及び1-[9-エチル-6-(2-メチルベンゾイル)-9H-カルバゾール-3-イル]-エタノン-1-(O-アセチルオキシム)等のオキシムエステル類等のラジカル型光硬化開始剤や、

p-メトキシフェニルジアゾニウムフロロホスホネート、及びN, N-ジエチルアミノフェニルジアゾニウムヘキサフロロホスホネート等のルイス酸のジアゾニウム塩；ジフェニルヨードニウムヘキサフロロホスホネート、及

びジフェニルヨードニウムヘキサフロロアンチモネート等のルイス酸のヨードニウム塩；トリフェニルスルホニウムヘキサフロロホスホネート、及びトリフェニルスルホニウムヘキサフロロアンチモネート等のルイス酸のスルホニウム塩；トリフェニルホスホニウムヘキサフロロアンチモネート等のルイス酸のホスホニウム塩；その他のハロゲン化物；トリアジン系開始剤；ポレート系開始剤；その他の光酸発生剤等のカチオン系光硬化開始剤が挙げられる。

[0168] 光硬化開始剤（C）としては、市販品を利用することもできる。市販品としては、例えば、IGM Resins社製OmniRad（登録商標）369（商品名）、IGM Resins社製OmniRad（登録商標）819（商品名）、IGM Resins社製OmniRad（登録商標）819DW（商品名）、IGM Resins社製OmniRad（登録商標）907（商品名）、IGM Resins社製OmniRad（登録商標）TPO（商品名）、IGM Resins社製OmniRad（登録商標）TPO-L（商品名）、IGM Resins社製OmniRad（登録商標）784（商品名）、BASFジャパン株式会社製Irgacure（登録商標）OXE01（商品名）、BASFジャパン株式会社製Irgacure（登録商標）OXE02（商品名）、BASFジャパン株式会社製Irgacure（登録商標）OXE03（商品名）、及びBASFジャパン株式会社製Irgacure（登録商標）OXE04（商品名）等が挙げられる。

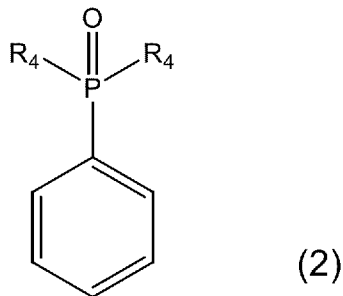
これらの光硬化開始剤（C）は、1種単独又は2種以上を適宜混合して使用することも可能である。

[0169] 本実施形態において、光硬化開始剤（C）は、0.01質量%で含まれるクロロホルム溶液を調製し、波長365nm（i線）を含む活性エネルギー線を用いて、光硬化開始剤（C）が0.01質量%で含まれるクロロホルム溶液の吸光度を測定した場合においては、その吸光度は0.1以上であることが好ましく、この光硬化開始剤（C）は非常に優れた吸光性を示す。また

、波長405nm（h線）を含む活性エネルギー線を用いて、光硬化開始剤（C）が0.01質量%で含まれるクロロホルム溶液の吸光度を測定した場合においては、その吸光度が0.1以上であることが好ましく、この場合においても非常に優れた吸光性を示す。該光硬化開始剤（C）を用いると、例えば、直接描画露光法を用いて高密度で高精細な配線形成（パターン）を有するプリント配線板を製造するに際し、波長405nm（h線）を含む活性エネルギー線を用いた場合でも、マレイミドの光ラジカル反応が効率的に起こる。なお、波長365nm（i線）における吸光度は、光硬化性により優れる樹脂組成物を得ることができることから、0.15以上であることがより好ましい。波長405nm（h線）における吸光度は、光硬化性により優れる樹脂組成物を得ることができることから、0.15以上であることがより好ましい。なお、波長365（i線）における吸光度、及び波長405nm（h線）における吸光度において、それぞれの上限は、例えば、99.9以下である。

[0170] 該光硬化開始剤（C）としては、下記式（2）で表される化合物が好ましい。

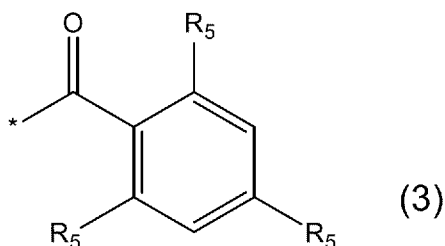
[0171] [化30]



[0172] 前記式（2）中、R₄は、各々独立に、下記式（3）で表される置換基又はフェニル基を表す。

[0173]

[化31]



[0174] 前記式 (3) 中、 R_5 は、各々独立に、水素原子又はメチル基を表す。式 (3) 中、 $*$ は、式 (2) 中のリン原子 (P) との結合手を示す。

[0175] 前記式 (2) で表される化合物は、この化合物が 0.01 質量% で含まれるクロロホルム溶液を調製し、波長 365 nm (i 線) を含む活性エネルギー線を用いてこのクロロホルム溶液の吸光度を測定した場合に、吸光度が 0.1 以上と、波長 365 nm (i 線) の光に対して非常に優れた吸収性を示す。そのため、この化合物は、波長 365 nm (i 線) の光に対して好適にラジカルを発生する。吸光度は、0.15 以上であることが好ましい。上限値は、例えば、5.0 以下であり、10.0 以下であってもよい。

[0176] また、前記式 (2) で表される化合物は、この化合物が 0.01 質量% で含まれるクロロホルム溶液を調製し、波長 405 nm (h 線) を含む活性エネルギー線を用いてこのクロロホルム溶液の吸光度を測定した場合に、吸光度が 0.1 以上と、波長 405 nm (h 線) の光に対して非常に優れた吸収性を示す。そのため、この化合物は、波長 405 nm (h 線) の光に対して好適にラジカルを発生する。吸光度は、0.15 以上であることが好ましい。上限値は、例えば、5.0 以下であり、10.0 以下であってもよい。

[0177] 式 (2) 中、 R_4 は、各々独立に、式 (3) で表される置換基又はフェニル基を表す。 R_4 のうち、1つ以上が式 (3) で表される置換基であることが好ましい。

式 (3) 中、 R_5 は、各々独立に水素原子又はメチル基を表す。 R_5 のうち、1つ以上がメチル基であることが好ましく、全てメチル基であることがより好ましい。

[0178] 前記式 (2) で表される化合物としては、例えば、2, 4, 6-トリメチ

ルベンゾイルージフェニルーフオスフィンオキシド、及びビス（2，4，6-トリメチルベンゾイル）-フェニルフォスフィンオキシド等のフォスフィンオキシド類が挙げられる。これらの中でも、優れた光透過性を有することから、ビス（2，4，6-トリメチルベンゾイル）-フェニルフォスフィンオキシドが好ましい。これらの化合物は、1種単独又は2種以上を適宜混合して使用することも可能である。

[0179] アシルフォスフィンオキシド類は、波長405nm（h線）を含む活性エネルギー線に対して非常に優れた吸収性を示し、例えば、波長405nm（h線）の透過率が5%以上であるビスマレイミド化合物（A）を好適にラジカル重合させることができる。そのため、特に多層プリント配線板に用いた際に、優れた光硬化性を有し、耐熱性、熱安定性及び絶縁信頼性をバランスよく優れる硬化物を得ることができる樹脂組成物、樹脂シート、それらを用いた多層プリント配線板、及び半導体装置を好適に製造することが可能となる。

[0180] 樹脂組成物において、光硬化開始剤（C）の含有量は、ビスマレイミド化合物（A）、及び樹脂又は化合物（B）の光硬化を十分に進行させ、より優れた耐熱性及び熱安定性を得るという観点から、ビスマレイミド化合物（A）、樹脂又は化合物（B）及び光硬化開始剤（C）の合計100質量部に対して、0.1～10質量部であることが好ましく、1～8質量部であることがより好ましく、2～7質量部であることが更に好ましい。

[0181] [充填材]

本実施形態の樹脂組成物には、塗膜性や耐熱性等の諸特性を向上させるために、充填材（D）（成分（D）とも称す）を含むこともできる。充填材（D）としては、絶縁性を有し、光硬化に用いる種々の活性エネルギー線に対する透過性を阻害しないものであることが好ましく、波長365nm（i線）、及び／又は波長405nm（h線）を含む活性エネルギー線に対する透過性を阻害しないものであることがより好ましい。

[0182] 充填材（D）としては、例えば、シリカ（例えば、天然シリカ、溶融シリ

カ、アモルファスシリカ、及び中空シリカ等）、アルミニウム化合物（例えば、ベーマイト、水酸化アルミニウム、アルミナ、及び窒化アルミニウム等）、ホウ素化合物（例えば、窒化ホウ素等）、マグネシウム化合物（例えば、酸化マグネシウム、及び水酸化マグネシウム等）、カルシウム化合物（例えば、炭酸カルシウム等）、モリブデン化合物（例えば、酸化モリブデン、及びモリブデン酸亜鉛等）、バリウム化合物（例えば、硫酸バリウム、及びケイ酸バリウム等）、タルク（例えば、天然タルク、及び焼成タルク等）、マイカ、ガラス（例えば、短繊維状ガラス、球状ガラス、微粉末ガラス、Eガラス、Tガラス、及びDガラス等）、シリコーンパウダー、フッ素樹脂系充填材、ウレタン樹脂系充填材、（メタ）アクリル樹脂系充填材、ポリエチレン系充填材、スチレン・ブタジエンゴム、並びにシリコーンゴム等が挙げられる。これらの充填材（D）は、1種単独又は2種以上を適宜混合して使用することも可能である。

[0183] これらの中でも、シリカ、ベーマイト、硫酸バリウム、シリコーンパウダー、フッ素樹脂系充填材、ウレタン樹脂系充填材、（メタ）アクリル樹脂系充填材、ポリエチレン系充填材、スチレン・ブタジエンゴム、及びシリコーンゴムことが好ましい。

これらの充填材（D）は、後述のシランカップリング剤等で表面処理されていてもよい。

[0184] 硬化物の耐熱性を向上させ、また良好な塗膜性が得られるという観点から、シリカが好ましく、熔融シリカがより好ましい。シリカの具体例としては、デンカ（株）製のSFP-130MC（商品名）、（株）アドマテックス製のSC2050-MB（商品名）、SC1050-MLE（商品名）、YA010C-MFN（商品名）、及びYA050C-MJA（商品名）等が挙げられる。

[0185] 充填材（D）の粒径は、樹脂組成物の紫外光透過性という観点から、通常0.005~10 μ mであり、好ましくは0.01~1.0 μ mである。

[0186] 本実施形態の樹脂組成物において、充填材（D）の含有量は、樹脂組成物

の光透過性や、硬化物の耐熱性を良好にするという観点から、ビスマレイミド化合物（A）、樹脂又は化合物（B）及び光硬化開始剤（C）の合計100質量部に対して、300質量部以下とすることが好ましく、200質量部以下とすることがより好ましく、100質量部以下とすることが更に好ましい。上限値は、30質量部以下であってもよく、20質量部以下であってもよく、10質量部以下であってもよい。なお、充填材（D）を含有する場合、下限値は、塗膜性や耐熱性等の諸特性を向上させる効果が得られる観点から、ビスマレイミド化合物（A）、樹脂又は化合物（B）及び光硬化開始剤（C）の合計100質量部に対して、通常1質量部である。

[0187] シランカップリング剤及び湿潤分散剤

本実施形態の樹脂組成物には、充填材の分散性、ポリマー及び／又は樹脂と、充填材との接着強度を向上させるために、シランカップリング剤及び／又は湿潤分散剤を併用することができる。

これらのシランカップリング剤としては、一般に無機物の表面処理に使用されているシランカップリング剤であれば、限定されない。具体例としては、3-アミノプロピルトリメトキシシラン、 γ -アミノプロピルトリエトキシシラン、3-アミノプロピルジメトキシメチルシラン、3-アミノプロピルジエトキシメチルシラン、N- β -(アミノエチル)- γ -アミノプロピルトリメトキシシラン、N-(2-アミノエチル)-3-アミノプロピルトリエトキシシラン、N-(2-アミノエチル)-3-アミノプロピルジメトキシメチルシラン、N-(2-アミノエチル)-3-アミノプロピルジエトキシメチルシラン、N-フェニル-3-アミノプロピルトリメトキシシラン、N-フェニル-3-アミノプロピルトリエトキシシラン、[3-(6-アミノヘキシルアミノ)プロピル]トリメトキシシラン、及び[3-(N,N-ジメチルアミノ)プロピル]トリメトキシシラン等のアミノシラン系； γ -グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、3-グリシドキシプロピルトリエトキシシラン、3-グリシドキシプロピルジメトキシメチルシラン、3-グリシドキシプロピルジエトキシメチルシラン、2-(3,4-エポ

キシシクロヘキシル) エチルトリメトキシシラン、及び [8-(グリシジルオキシ)-n-オクチル] トリメトキシシラン等のエポキシシラン系；ビニルトリス(2-メトキシエトキシ)シラン、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、ジメトキシメチルビニルシラン、ジエトキシメチルビニルシラン、トリメトキシ(7-オクテン-1-イル)シラン、及びトリメトキシ(4-ビニルフェニル)シランなどのビニルシラン系；3-メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン、3-メタクリロキシプロピルトリエトキシシラン、3-メタクリロキシプロピルジメトキシメチルシラン、3-メタクリロキシプロピルジエトキシメチルシランなどのメタクリルシラン系、 γ -アクリロキシプロピルトリメトキシシラン、及び3-アクリロキシプロピルトリエトキシシラン等の(メタ)アクリルシラン系；3-イソシアネートプロピルトリメトキシシラン、及び3-イソシアネートプロピルトリエトキシシランなどのイソシアネートシラン系；トリス-(トリメトキシシリルプロピル)イソシアヌレートなどのイソシアヌレートシラン系；3-メルカプトプロピルトリメトキシシラン、及び3-メルカプトプロピルジメトキシメチルシランなどのメルカプトシラン系；3-ウレイドプロピルトリエトキシシランなどのウレイドシラン系；p-スチリルトリメトキシシランなどのスチリルシラン系；N- β -(N-ビニルベンジルアミノエチル)- γ -アミノプロピルトリメトキシシラン塩酸塩等のカチオンシラン系；[3-(トリメトキシシリル)プロピル]コハク酸無水物などの酸無水物系；フェニルトリメトキシシラン、フェニルトリエトキシシラン、ジメトキシメチルフェニルシラン、ジエトキシメチルフェニルシラン、及びp-トリルトリメトキシシラン等のフェニルシラン系トリメトキシ(1-ナフチル)シランなどのアリールシラン系が挙げられる。これらのシランカップリング剤は、1種単独又は2種以上を適宜混合して使用することも可能である。

[0188] 本実施形態の樹脂組成物において、シランカップリング剤の含有量は、通常、ビスマレイミド化合物(A)、樹脂又は化合物(B)及び光硬化開始剤(C)の合計100質量部に対して、0.1~10質量部である。

湿潤分散剤としては、塗料用に使用されている分散安定剤であれば、特に限定されない。具体例としては、ビッグケミー・ジャパン（株）製のDISPERBYK（登録商標）-110（商品名）、111（商品名）、118（商品名）、180（商品名）、161（商品名）、BYK（登録商標）-W996（商品名）、W9010（商品名）、W903（商品名）等の湿潤分散剤が挙げられる。これらの湿潤分散剤は、1種単独又は2種以上を適宜混合して使用することも可能である。

本実施形態の樹脂組成物において、湿潤分散剤の含有量は、通常、ビスマレイミド化合物（A）、樹脂又は化合物（B）及び光硬化開始剤（C）の合計100質量部に対して、0.1～10質量部である。

[0189] [硬化促進剤]

本実施形態の樹脂組成物には、必要に応じて、硬化速度を適宜調節するために、硬化促進剤を含むことが好ましい。硬化促進剤としては、シアン酸エステル化合物等の硬化促進剤として一般に使用されているものを用いることができる。硬化促進剤としては、例えば、オクチル酸亜鉛、ナフテン酸亜鉛、ナフテン酸コバルト、ナフテン酸銅、アセチルアセトン鉄、オクチル酸ニッケル、及びオクチル酸マンガン等の有機金属塩類；フェノール、キシレノール、クレゾール、レゾルシン、カテコール、オクチルフェノール、及びノニルフェノール等のフェノール化合物；1-ブタノール、及び2-エチルヘキサノール等のアルコール類；2-メチルイミダゾール、2-エチル-4-メチルイミダゾール、2-フェニルイミダゾール、1-シアノエチル-2-フェニルイミダゾール、1-シアノエチル-2-エチル-4-メチルイミダゾール、2-フェニル-4,5-ジヒドロキシメチルイミダゾール、及び2-フェニル-4-メチル-5-ヒドロキシメチルイミダゾール等のイミダゾール類及びこれらのイミダゾール類のカルボン酸もしくはその酸無水類の付加体等の誘導体；ジシアンジアミド、ベンジルジメチルアミン、及び4-メチル-N,N-ジメチルベンジルアミン等のアミン類；ホスフィン系化合物、ホスフィンオキサイド系化合物、ホスホニウム塩系化合物、及びダイホス

フィン系化合物等のリン化合物；エポキシイミダゾールアダクト系化合物；ベンゾイルパーオキサイド、p-クロロベンゾイルパーオキサイド、ジブチルパーオキサイド、ジイソプロピルパーオキシカーボネート、及びジ-2-エチルヘキシルパーオキシカーボネート等の過酸化物；2, 2'-アゾビスイソブチロニトリル（以下、「AIBN」とも称す）等のアゾ化合物が挙げられる。これらの硬化促進剤は、1種単独又は2種以上を適宜混合して使用することも可能である。

本実施形態の樹脂組成物において、硬化促進剤の含有量は、通常、ビスマレイミド化合物（A）、樹脂又は化合物（B）及び光硬化開始剤（C）の合計100質量部に対して、0.1～20質量部である。

[0190] 〔有機溶剤〕

本実施形態の樹脂組成物には、必要に応じて、有機溶剤を含んでもよい。有機溶剤を用いると、樹脂組成物の調製時における粘度を調整することができる。有機溶剤の種類は、樹脂組成物中の樹脂の一部又は全部を溶解可能なものであれば、特に限定されない。有機溶剤としては、例えば、アセトン、メチルエチルケトン、及びメチルイソブチルケトン等のケトン類；シクロペンタノン、及びシクロヘキサノン等の脂環式ケトン類；プロピレングリコールモノメチルエーテル、及びプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート等のセロソルブ系溶媒；乳酸エチル、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸ブチル、酢酸イソアミル、メトキシプロピオン酸メチル、ヒドロキシイソ酪酸メチル、及びγ-ブチロラクトン等のエステル系溶媒；ジメチルアセトアミド、及びジメチルホルムアミド等のアミド類などの極性溶剤類；トルエン、キシレン及びアニソール等の芳香族炭化水素等の無極性溶剤が挙げられる。

これらの有機溶剤は、1種単独又は2種以上を適宜混合して使用することも可能である。

[0191] 〔その他の成分〕

本実施形態の樹脂組成物には、本実施形態の特性が損なわれない範囲にお

いて、これまでに挙げられていない熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂、及びそのオリゴマー、並びにエラストマー類等の種々の高分子化合物；これまでに挙げられていない難燃性の化合物；添加剤等の併用も可能である。これらは一般に使用されているものであれば、特に限定されない。例えば、難燃性の化合物では、メラミンやベンゾグアナミン等の窒素含有化合物、オキサジン環含有化合物、及びリン系化合物のホスフェート化合物、芳香族縮合リン酸エステル、含ハロゲン縮合リン酸エステル等が挙げられる。添加剤としては、紫外線吸収剤、酸化防止剤、蛍光増白剤、光増感剤、染料、顔料、増粘剤、滑剤、消泡剤、表面調整剤、光沢剤、重合禁止剤、熱硬化促進剤等が挙げられる。これらの成分は、1種単独又は2種以上を適宜混合して使用することも可能である。

本実施形態の樹脂組成物において、その他の成分の含有量は、通常、ビスマレイミド化合物（A）、樹脂又は化合物（B）及び光硬化開始剤（C）の合計100質量部に対して、それぞれ0.1～10質量部である。

[0192] 〔樹脂組成物の製造方法〕

本実施形態の樹脂組成物は、ビスマレイミド化合物（A）、樹脂又は化合物（B）、光硬化開始剤（C）と、必要に応じて、充填材（D）、その他の樹脂、その他の化合物、及び添加剤等を適宜混合することにより調製される。樹脂組成物は、後述する本実施形態の樹脂シートを作製する際のワニスとして、好適に使用することができる。なお、ワニスの調製に使用する有機溶媒は、特に限定されず、その具体例は、前記したとおりである。

[0193] 樹脂組成物の製造方法は、例えば、前記した各成分を順次溶剤に配合し、十分に攪拌する方法が挙げられる。樹脂組成物は、光硬化性に優れ、樹脂組成物から得られる硬化物は、耐熱性、熱安定性、及び絶縁信頼性に優れる。

[0194] 樹脂組成物の製造時には、必要に応じて、各成分を均一に溶解又は分散させるための公知の処理（攪拌、混合、混練処理等）を行うことができる。具体的には、適切な攪拌能力を有する攪拌機を付設した攪拌槽を用いて攪拌分散処理を行うことにより、樹脂組成物における各成分の分散性を向上させる

ことができる。攪拌、混合、混練処理は、例えば、超音波ホモジナイザー等の分散を目的とした攪拌装置、三本ロール、ボールミル、ビーズミル、サンドミル等の混合を目的とした装置、並びに、公転又は自転型の混合装置等の公知の装置を用いて適宜行うことができる。また、樹脂組成物の調製時には、必要に応じて有機溶剤を使用することができる。有機溶剤の種類は、樹脂組成物中の樹脂を溶解可能なものであれば、特に限定されず、その具体例は、前記したとおりである。

[0195] 樹脂組成物は、後述する本実施形態の樹脂シートを作製する際のワニスとして、好適に使用することができる。ワニスは、公知の方法により得ることができる。例えば、ワニスは、本実施形態の樹脂組成物中の有機溶媒を除く成分100質量部に対して、有機溶剤を10～900質量部加えて、前記の公知の混合処理（攪拌、混練処理等）を行うことで得ることができる。

[0196] [用途]

樹脂組成物は、絶縁信頼性の樹脂組成物が必要とされる用途に好ましく使用することができる。用途としては、例えば、感光性フィルム、支持体付き感光性フィルム、プリプレグ、樹脂シート、回路基板（積層板用途、多層プリント配線板用途等）、ソルダーレジスト、アンダーフィル材、ダイボンディング材、半導体封止材、穴埋め樹脂、及び部品埋め込み樹脂等に使用することができる。それらの中でも、樹脂組成物は、光硬化性、耐熱性及び熱安定性に優れるため、多層プリント配線板の絶縁層用として、又はソルダーレジスト用として好適に使用することができる。

[0197] [硬化物]

硬化物は、本実施形態の樹脂組成物を硬化させてなる。硬化物は、例えば、樹脂組成物を溶融又は溶媒に溶解させた後、型内に流し込み、光を用いて通常 conditions で硬化させることにより得ることができる。光の波長領域は、光重合開始剤等により効率的に硬化が進む100～500nmの範囲で硬化させることが好ましい。

[0198] [樹脂シート]

本実施形態の樹脂シートは、支持体と、支持体の片面又は両面に配された樹脂層と、を有し、樹脂層が、樹脂組成物を含む、支持体付き樹脂シートである。樹脂シートは、樹脂組成物を支持体上に塗布、及び乾燥して製造することができる。樹脂シートにおける樹脂層は、優れた耐熱性、熱安定性及び絶縁信頼性を有する。

[0199] 支持体は、公知のものを使用することができるが、樹脂フィルムであることが好ましい。樹脂フィルムとしては、例えば、ポリイミドフィルム、ポリアミドフィルム、ポリエステルフィルム、ポリエチレンテレフタレート（PET）フィルム、ポリブチレンテレフタレート（PBT）フィルム、ポリプロピレン（PP）フィルム、ポリエチレン（PE）フィルム、ポリエチレンナフタレートフィルム、ポリビニルアルコールフィルム、及びトリアセチルアセテートフィルム等が挙げられる。それらの中でも、PETフィルムが好ましい。

[0200] 樹脂フィルムは、樹脂層からの剥離を容易にするため、剥離剤を表面に塗布してあることが好ましい。樹脂フィルムの厚さは、5～100 μm の範囲であることが好ましく、10～50 μm の範囲であることがより好ましい。この厚さが5 μm 未満では、現像前に行う支持体剥離の際に支持体が破れやすくなる傾向があり、厚さが100 μm を超えると、支持体上から露光する際の解像度が低下する傾向がある。

[0201] また、露光時の光の散乱を低減するため、樹脂フィルムは透明性に優れるものが好ましい。

[0202] さらに、本実施形態における樹脂シートにおいて、その樹脂層は、保護フィルムで保護されていてもよい。

樹脂層側を保護フィルムで保護することにより、樹脂層表面へのゴミ等の付着やキズを防止することができる。保護フィルムとしては、樹脂フィルムと同様の材料により構成されたフィルムを用いることができる。保護フィルムの厚さは、1～50 μm の範囲であることが好ましく、5～40 μm の範囲であることがより好ましい。厚さが1 μm 未満では、保護フィルムの取り

扱い性が低下する傾向にあり、50 μ mを超えると廉価性に劣る傾向にある。なお、保護フィルムは、樹脂層と支持体との接着力に対して、樹脂層と保護フィルムとの接着力の方が小さいものが好ましい。

[0203] 本実施形態の樹脂シートの製造方法は、例えば、本実施形態の樹脂組成物をPETフィルム等の支持体に塗布して、乾燥することにより有機溶剤を除去することで、樹脂シートを製造する方法等が挙げられる。

塗布方法は、例えば、ロールコーター、コンマコーター、グラビアコーター、ダイコーター、バーコーター、リップコーター、ナイフコーター、及びスクイズコーター等を用いた公知の方法で行うことができる。乾燥は、例えば、60～200℃の乾燥機中で、1～60分加熱させる方法等により行うことができる。

[0204] 樹脂層中に残存する有機溶剤量は、後の工程での有機溶剤の拡散を防止する観点から、樹脂層の総質量に対して5質量%以下とすることが好ましい。樹脂層の厚さは、取り扱い性を向上させるという観点から、1～50 μ mとすることが好ましい。

[0205] 樹脂シートは、多層プリント配線板の絶縁層の製造用として好ましく使用することができる。

[0206] [多層プリント配線板]

本実施形態の多層プリント配線板は、絶縁層と、絶縁層の片面又は両面に形成された導体層とを有し、絶縁層が、樹脂組成物を含む。絶縁層は、例えば、樹脂シートを1枚以上重ねて硬化して得ることもできる。絶縁層と導体層のそれぞれの積層数は、特に限定されず、目的とする用途に応じて適宜積層数を設定することができる。また、絶縁層と導体層の順番も特に限定されない。導体層としては、各種プリント配線板材料に用いられる金属箔であってもよく、例えば、銅、及びアルミニウム等の金属箔が挙げられる。銅の金属箔としては、圧延銅箔、及び電解銅箔等の銅箔が挙げられる。導体層の厚みは、通常、1～100 μ mである。具体的には、以下の方法により製造することができる。

[0207] (ラミネート工程)

ラミネート工程では、樹脂シートの樹脂層側を、真空ラミネーターを用いて回路基板の片面又は両面にラミネートする。回路基板としては、例えば、ガラスエポキシ基板、金属基板、セラミック基板、シリコン基板、半導体封止樹脂基板、ポリエステル基板、ポリイミド基板、BTレジン基板、及び熱硬化型ポリフェニレンエーテル基板等が挙げられる。なお、回路基板とは、基板の片面又は両面にパターン加工された導体層（回路）が形成された基板をいう。また、導体層と絶縁層とを交互に積層してなる多層プリント配線板において、多層プリント配線板の最外層の片面又は両面がパターン加工された導体層（回路）となっている基板も回路基板に含まれる。なお、この多層プリント配線板に積層されている絶縁層は、本実施形態の樹脂シートを1枚以上重ねて硬化して得られた絶縁層であってもよく、本実施形態の樹脂シートと、本実施形態の樹脂シートと異なる公知の樹脂シートとをそれぞれ1枚以上重ねて得られた絶縁層であってもよい。なお、本実施形態の樹脂シートと、本実施形態の樹脂シートと異なる公知の樹脂シートとの重ね方は、特に限定されない。導体層表面には、黒化处理、及び／又は銅エッチング等により予め粗化处理が施されていてもよい。ラミネート工程において、樹脂シートが保護フィルムを有している場合には、保護フィルムを剥離除去した後、必要に応じて樹脂シート及び回路基板をプレヒートし、樹脂シートの樹脂層を加圧及び加熱しながら回路基板に圧着する。本実施形態においては、真空ラミネート法により減圧下で回路基板に樹脂シートの樹脂層をラミネートする方法が好適に用いられる。

[0208] ラミネート工程の条件は、例えば、圧着温度（ラミネート温度）を50～140℃とし、圧着圧力を1～15kgf/cm²とし、圧着時間を5～300秒間とし、空気圧を20mmHg以下とする減圧下でラミネートすることが好ましい。また、ラミネート工程は、バッチ式であってもロールを用いる連続式であってもよい。真空ラミネート法は、市販の真空ラミネーターを使用して行うことができる。市販の真空ラミネーターとしては、例えば、ニッ

コー・マテリアルズ（株）製２ステージビルドアップラミネーター（商品名）等を挙げることができる。

[0209] （露光工程）

露光工程では、ラミネート工程により、回路基板上に樹脂層が設けられた後、樹脂層の所定部分に光源として、活性エネルギー線を照射し、照射部の樹脂層を硬化させる。

照射は、マスクパターンを通してよいし、直接照射する直接描画法を用いてもよい。活性エネルギー線としては、例えば、紫外線、可視光線、電子線、及びX線等が挙げられる。活性エネルギー線の波長としては、例えば、200～600 nmの範囲である。紫外線を用いる場合、その照射量はおおむね10～1000 mJ/cm²である。また、ステッパー露光法を用いて高密度で高精細な配線形成（パターン）を有するプリント配線板を製造するに際しては、活性エネルギー線として、例えば、波長365 nm（i線）を含む活性エネルギー線を用いることが好ましい。波長365 nm（i線）を含む活性エネルギー線を用いた場合、その照射量は、おおむね10～10,000 mJ/cm²である。直接描画露光法を用いて高密度で高精細な配線形成（パターン）を有するプリント配線板を製造するに際しては、活性エネルギー線として、例えば、波長405 nm（h線）を含む活性エネルギー線を用いることが好ましい。波長405 nm（h線）を含む活性エネルギー線を用いた場合、その照射量は、おおむね10～10,000 mJ/cm²である。

マスクパターンを通す露光方法には、マスクパターンを多層プリント配線板に密着させて行う接触露光法と、密着させずに平行光線を使用して露光する非接触露光法とがあるが、どちらを用いてもかまわない。また、樹脂層上に支持体が存在している場合は、支持体上から露光してもよいし、支持体を剥離後に露光してもよい。

[0210] （現像工程）

本実施形態では、必要に応じて、現像工程を含んでもよい。

すなわち、樹脂層上に支持体が存在していない場合には、露光工程後、ウ

エット現像にて光硬化されていない部分（未露光部）を除去し、現像することにより、絶縁層のパターンを形成することができる。また、樹脂層上に支持体が存在している場合には、露光工程後、その支持体を除去した後に、ウエット現像にて光硬化されていない部分（未露光部）を除去し、現像することにより、絶縁層のパターンを形成することができる。

[0211] ウエット現像の場合、現像液としては、未露光部分を選択的に溶出するものであれば、特に限定されない。例えば、シクロヘキサノン、シクロペンタノン、及びγ-ブチロラクトン等の有機溶媒；水酸化テトラメチルアンモニウム水溶液、炭酸ナトリウム水溶液、炭酸カリウム水溶液、水酸化ナトリウム水溶液、及び水酸化カリウム水溶液等のアルカリ現像液が用いられる。これらの現像液は、1種単独又は2種以上を適宜混合して使用することも可能である。

[0212] また、現像方法としては、例えば、ディップ、パドル、スプレー、揺動浸漬、ブラッシング、スクラッピング等の公知の方法で行うことができる。パターン形成においては、必要に応じて、これらの現像方法を併用して用いてもよい。また、現像方法としては、高圧スプレーを用いることが、解像度がより向上するため、好適である。スプレー方式を採用する場合のスプレー圧としては、0.02～0.5 MPaが好ましい。

[0213] （ポストバーク工程）

露光工程終了後、又は現像工程終了後、ポストバーク工程を行い、絶縁層（硬化物）を形成する。ポストバーク工程としては、高圧水銀ランプによる紫外線照射工程やクリーンオープンを用いた加熱工程等が挙げられ、これらを併用することも可能である。紫外線を照射する場合は、必要に応じてその照射量を調整することができ、例えば、50～10,000 mJ/cm²程度の照射量で照射を行うことができる。また加熱の条件は、必要に応じて適宜選択できるが、好ましくは150～220℃で20～180分間の範囲、より好ましくは160～200℃で30～150分間の範囲で選択される。

[0214] （導体層形成工程）

絶縁層（硬化物）を形成後、乾式めっきにより絶縁層表面に導体層を形成する。乾式めっきとしては、蒸着法、スパッタリング法、及びイオンプレーティング法等の公知の方法を使用することができる。蒸着法（真空蒸着法）は、例えば、多層プリント配線板を真空容器内に入れ、金属を加熱蒸発させることにより、絶縁層上に金属膜を形成することができる。スパッタリング法も、例えば、多層プリント配線板を真空容器内に入れ、アルゴン等の不活性ガスを導入し、直流電圧を印加して、イオン化した不活性ガスをターゲット金属に衝突させ、叩き出された金属により絶縁層上に金属膜を形成することができる。

[0215] 次いで、無電解めっきや電解めっきなどによって導体層を形成する。その後のパターン形成の方法としては、例えば、サブトラクティブ法、セミアディティブ法等を用いることができる。

[0216] [封止用材料]

本実施形態の封止用材料は、本実施形態の樹脂組成物を含む。封止用材料の製造方法としては、一般に公知の方法を適宜適用でき、特に限定されない。例えば、本実施形態の樹脂組成物と、封止材料用途で一般的に用いられる各種公知の添加剤あるいは溶媒等を、公知のミキサーを用いて混合することで封止用材料を製造することができる。なお、混合の際の、本実施形態のマレイミド化合物、各種添加剤、溶媒の添加方法は、一般に公知の方法を適宜適用でき、特に限定されない。

[0217] [繊維強化複合材料]

本実施形態の繊維強化複合材料は、本実施形態の樹脂組成物と、強化繊維とを含む。強化繊維としては、一般的に公知のものを用いることができ、特に限定されない。例えば、Eガラス、Dガラス、Lガラス、Sガラス、Tガラス、Qガラス、UNガラス、NEガラス、球状ガラス等のガラス繊維；炭素繊維；アラミド繊維；ポロン繊維；PBO繊維；高強力ポリエチレン繊維；アルミナ繊維；炭化ケイ素繊維が挙げられる。強化繊維の形態や配列については、特に限定されず、織物、不織布、マット、ニット、組み紐、一方向

ストランド、ロービング、及びチョップド等から適宜選択できる。また、強化繊維の形態としてプリフォーム（強化繊維からなる織物基布を積層したもの、又はこれをステッチ糸により縫合一体化したもの、あるいは立体織物や編組物などの繊維構造物）を適用することもできる。

[0218] これら繊維強化複合材料の製造方法としては、一般に公知の方法を適宜適用でき、特に限定されない。例えば、リキッド・コンポジット・モールディング法、レジン・フィルム・インフュージョン法、フィラメント・ワインディング法、ハンド・レイアップ法、及びプルトルージョン法が挙げられる。これらの中でも、リキッド・コンポジット・モールディング法の一つであるレジン・トランスファー・モールディング法は、金属板、フォームコア、ハニカムコア等、プリフォーム以外の素材を成型型内に予めセットしておくことができることから、種々の用途に対応可能であるため、比較的、形状が複雑な複合材料を短時間で大量生産する場合に好ましく用いられる。

[0219] [接着剤]

本実施形態の接着剤は、本実施形態の樹脂組成物を含む。接着剤の製造方法としては、一般に公知の方法を適宜適用でき、特に限定されない。例えば、本実施形態の樹脂組成物と、接着剤用途で一般的に用いられる各種公知の添加剤あるいは溶媒等を、公知のミキサーを用いて混合することで接着剤を製造することができる。なお、混合の際の、本実施形態のマレイミド化合物、各種添加剤、溶媒の添加方法は、一般に公知の方法を適宜適用でき、特に限定されない。

[0220] [半導体装置]

本実施形態の半導体装置は、樹脂組成物を含む。具体的には、以下の方法により製造することができる。多層プリント配線板の導通箇所、半導体チップを実装することにより半導体装置を製造することができる。ここで、導通箇所とは、多層プリント配線板における電気信号を伝える箇所のことであって、その場所は表面であっても、埋め込まれた箇所であってもよい。また、半導体チップは、半導体を材料とする電気回路素子であれば特に限定され

ない。

[0221] 半導体装置を製造する際の半導体チップの実装方法は、半導体チップが有効に機能すれば、特に限定されない。具体的には、ワイヤボンディング実装方法、フリップチップ実装方法、バンプなしビルドアップ層（BBUL）による実装方法、異方性導電フィルム（ACF）による実装方法、及び非導電性フィルム（NCF）による実装方法等が挙げられる。

[0222] また、半導体チップや半導体チップを搭載してある基板に樹脂組成物を含む絶縁層を形成することによっても、半導体装置を製造することができる。半導体チップを搭載してある基板の形状はウェハ状でもパネル状でも良い。形成後は多層プリント配線板と同様の方法を用いて製造することができる。

実施例

[0223] 以下、本実施形態を実施例及び比較例を用いてより具体的に説明する。本実施形態は、以下の実施例によって何ら限定されるものではない。

分子量の測定条件は以下の通りである。

機種：GPC TOSOH HLC-8220GPC

カラム：Super HZM-N

溶離液：THF（テトラヒドロフラン）；0.35ml/分、40℃

検出器：RI（示差屈折計）

分子量標準：ポリスチレン

[0224] <ビスマレイミド化合物の合成>

[合成例1]

フッ素樹脂コーティングされた攪拌バーを装備した500mlの丸底フラスコに、100gのトルエンと33gのN-メチルピロリドンを投入した。次にPRIAMINE 1075（クローダジャパン株式会社製）80.2g（0.16mol）を加え、ついで無水メタンスルホン酸14.4g（0.16mol）をゆっくりと加え、塩を形成した。ほぼ10分間攪拌して混合し、ついで4-（2,5-ジオキソテトラヒドロフラン-3-イル）-1,2,3,4-テトラヒドロナフタレン-1,2ジカルボン酸無水物（22

、5 g、0.08 mol) を、攪拌された混合物にゆっくり加えた。ディーンスタークトラップとコンデンサーをフラスコに取り付けた。混合物を6時間熱して還流し、アミン末端のジイミドを形成した。この縮合からの生成水の理論量は、この時までには得られた。反応混合物は、室温以下に冷却され、無水マレイン酸の17.6 g (0.19 mol) がフラスコに加えられた。混合物は、さらに8時間還流され、期待された量の生成水を得た。室温に冷却された後、さらにトルエン200 ml がフラスコに加えられた。次に、希釈された有機層を水(100 ml × 3回)で洗浄し、塩や未反応の原料を除去した。その後、溶剤を真空下で除去し、暗琥珀色液状のビスマレイミド化合物104 g (収率93%、Mw=3,700) を得た(A-1)。

[0225] [比較合成例1]

フッ素樹脂コーティングされた攪拌バーを装備した500 ml の丸底フラスコに、110 g のトルエンと36 g のN-メチルピロリドンを投入した。次にPRIAMINE 1075 (クローダジャパン株式会社製) 90.5 g (0.17 mol) を加え、ついで無水メタンスルホン酸16.3 g (0.17 mol) をゆっくりと加え、塩を形成した。ほぼ10分間攪拌して混合し、ついで1, 2, 4, 5-シクロヘキサンテトラカルボン酸二無水物(18.9 g、0.08 mol) を、攪拌された混合物にゆっくり加えた。ディーンスタークトラップとコンデンサーをフラスコに取り付けた。混合物を6時間熱して還流し、アミン末端のジイミドを形成した。この縮合からの生成水の理論量は、この時までには得られた。反応混合物は、室温以下に冷却され、無水マレイン酸19.9 g (0.20 mol) がフラスコに加えられた。混合物は、さらに8時間還流され、期待された量の生成水を得た。室温に冷却された後、さらにトルエン200 ml がフラスコに加えられた。次に、希釈された有機層を水(100 ml × 3回)で洗浄し、塩や未反応の原料を除去した。その後、溶剤を真空下で除去し、琥珀色ワックス状のビスマレイミド化合物110 g (収率92%、Mw=3,000) を得た(A'-3)。

[0226] <シアン酸エステル化合物の合成>

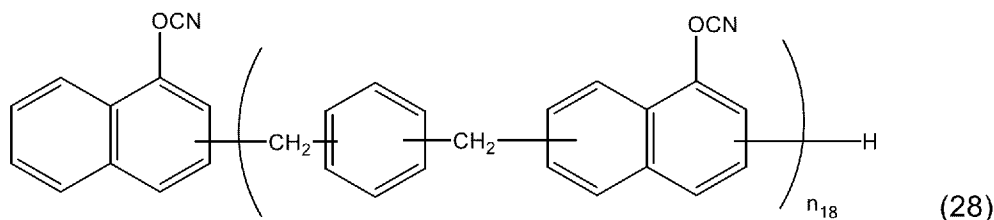
[合成例2]

α -ナフトールアラルキル型フェノール樹脂（新日鐵化学（株）製SN495V（商品名）、OH基当量：236g/eq.、ナフトールアラルキルの繰り返し単位数nは1～5のものが含まれる）0.47mol（OH基換算）を、クロロホルム500mLに溶解させ、この溶液にトリエチルアミン0.7molを添加した（溶液1）。

温度を-10℃に保ちながら、0.93molの塩化シアンのクロロホルム溶液300gに対して、溶液1を1.5時間かけて滴下し、滴下終了後、30分攪拌した。

その後さらに、0.1molのトリエチルアミンとクロロホルム30gの混合溶液を反応器内に滴下し、30分攪拌して反応を完結させた。副生したトリエチルアミンの塩酸塩を反応液から濾別した後、得られた濾液を0.1N塩酸500mLで洗浄した後、水500mLでの洗浄を4回繰り返した。これを硫酸ナトリウムにより乾燥した後、75℃でエバポレートし、さらに90℃で減圧脱気することにより、褐色固形の α -ナフトールアラルキル型シアン酸エステル樹脂（SNCN、式（28）、 n_{18} は1～4のものが含まれる）を得た（B-2）。得られた α -ナフトールアラルキル型シアン酸エステル樹脂を赤外吸収スペクトルにより分析したところ、2264cm⁻¹付近のシアン酸エステル基の吸収が確認された。

[0227] [化32]



[0228] <エチレン性不飽和基を有する化合物の合成>

[合成例3]

温度計、冷却管、攪拌機を取り付けたフラスコにXD-1000（日本化薬（株）製、軟化点74.8℃、エポキシ当量255g/eq.）を225g

、アクリル酸を72.1g、触媒としてトリフェニルホスフィン3g、溶剤としてプロピレングリコールモノメチルエーテルモノアセテートを固形分含有量80%となるように加え、100℃で24時間反応させ、反応中間体であるエポキシカルボキシレート化合物溶液を得た。

続いて、得られた反応性エポキシカルボキシレート化合物溶液に、多塩基酸無水物として1,2,3,6-テトラヒドロフタル酸無水物（THPA）（商品名：リカシッドTH、新日本理化（株）製）を140g入れ、溶剤として固形分含有量が65%となるようにプロピレングリコールモノメチルエーテルモノアセテートを加え、100℃で6時間反応させ、エチレン性不飽和基を有する化合物（B-6）を得た。得られたエチレン性不飽和基を有する化合物（B-6）の固形分酸価（AV：mg KOH/g）は110であった。

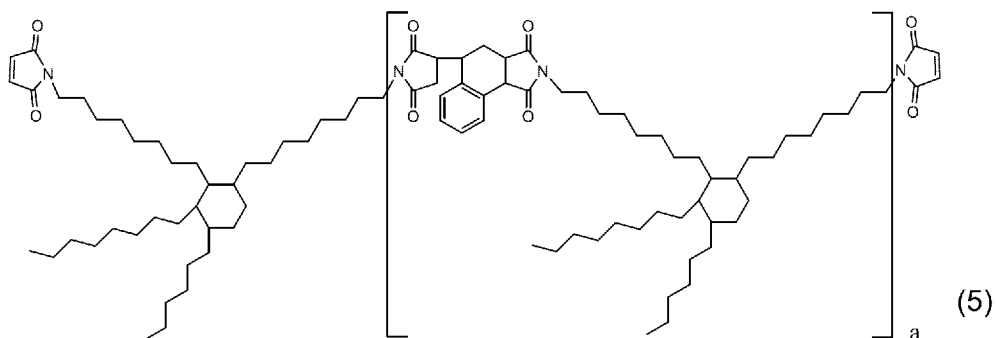
[0229] 本実施例で用いた材料について示す。

[0230] < (A) ビスマレイミド化合物 >

(A-1) 一般式(1)で表される構成単位と、分子鎖の両末端にマレイミド基を含む、ビスマレイミド樹脂

合成例1のビスマレイミド樹脂A-1（下記式(3)で表される化合物、25℃で高粘度液体）

[0231] [化33]



[0232] 式(5)中、aは、1～10の整数を示す。aは、より好適な粘度が得られ、ワニスの粘度上昇がより制御できる点から、1～6の整数であることが好ましい。

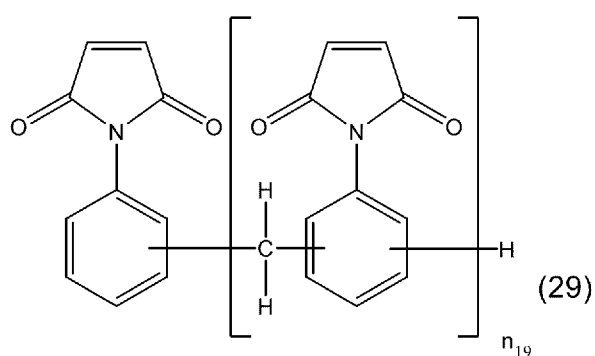
[0233] < (A') 一般式 (1) を満たさないビスマレイミド化合物 >

(A' - 1) BMI-2300 (ポリフェニルメタンマレイミド、下記式 (29) で表される化合物、大和化成 (株) 製、25℃で固形)

(A' - 2) BMI-3000 (下記式 (14) で表される化合物、DESIGNER MOLECULES Inc. 製、25℃で固形)

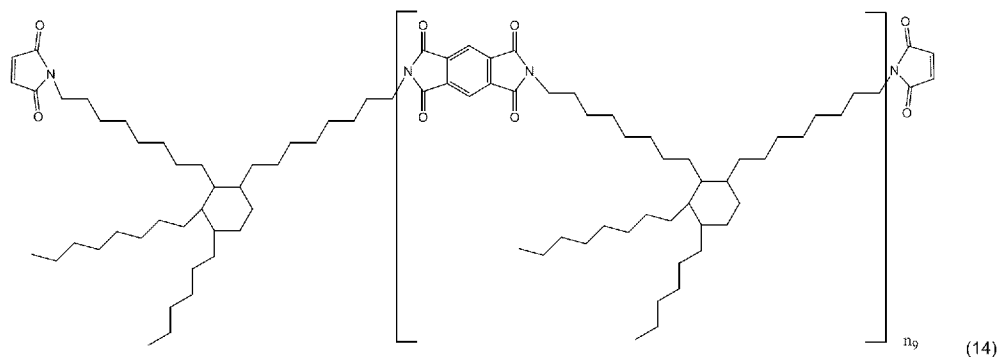
(A' - 3) 比較合成例 1 (下記式 (30) で表される化合物、25℃で液状)

[0234] [化34]



[0235] 前記式 (29) 中、 n_{19} は、1 以上の整数を表し、好ましくは 1 ~ 10 の整数を表し、より好ましくは 1 ~ 5 の整数を表す。

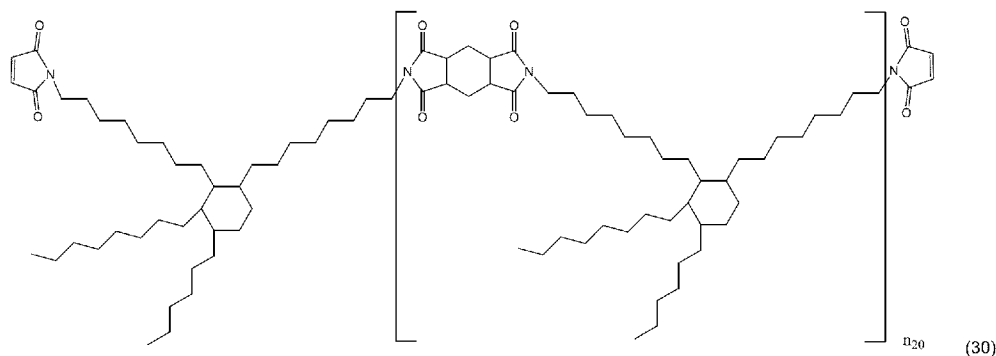
[0236] [化35]



[0237] 前記式 (14) 中、 n_9 は、1 以上の整数を表し、好ましくは 1 ~ 10 の整数を表す。

[0238]

[化36]



[0239] 前記式(30)中、 n_{20} は、1以上の整数を表し、好ましくは1～6の整数を表す。

[0240] <(B)樹脂又は化合物>

(B-1) ビスマレイミド樹脂であるMIR-5000(下記式(31))で表される化合物、日本化薬(株)製、25℃で固形)

(B-2) 合成例2で得られた α -ナフトールアラルキル型シアン酸エステル樹脂(SNCN、シアン酸エステル樹脂)

(B-3) P-d型ベンゾオキサジン化合物(四国化成工業(株)製、3,3'-(メチレン-1,4-ジフェニレン)ビス(3,4-ジヒドロ-2H-1,3-ベンゾオキサジン)、ベンゾオキサジン化合物)

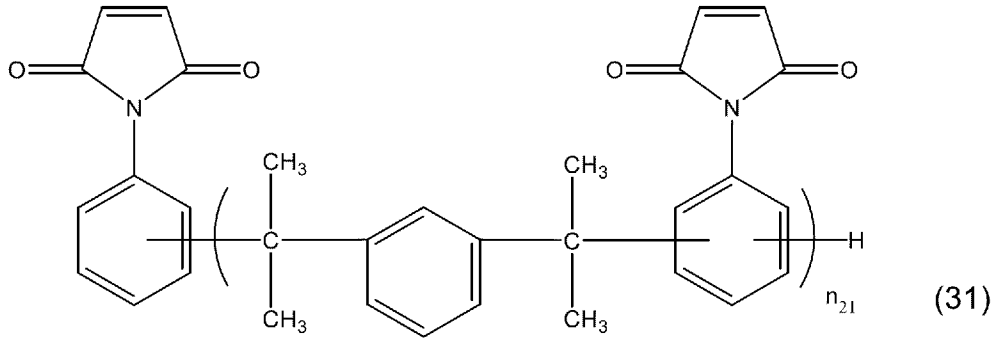
(B-4) ビフェニルアラルキル型エポキシ樹脂(日本化薬(株)製NC-3000H(商品名)、エポキシ樹脂)

(B-5) カルボジイミド化合物(日清紡ケミカル(株)製カルボジライトB-01(商品名))

(B-6) 合成例3で得られた酸変性ジシクロペンタジエンフェノール型エポシアクリレート化合物(日本化薬(株)製KAYARAD(登録商標)ZXR-1889H(商品名)、エチレン性不飽和基を有する化合物)

[0241]

[化37]



[0242] 前記式(31)中、 n_{21} は、1~10の整数を示す。

[0243] <(C) 光重合開始剤>

(C-1) ビス(2,4,6-トリメチルベンゾイル)-フェニルフォスフィンオキサイド(IGM Resins社製OmniRad(登録商標)819(商品名))

(C-2) 2-ベンジル-2-ジメチルアミノ-1-(4-モルフォリノフェニル)-ブタノン-1(IGM Resins社製OmniRad(登録商標)369(商品名))

(C-3) 2-メチル-1-[4-(メチルチオ)フェニル]-2-モルフォリノプロパン-1-オン(IGM Resins社製OmniRad(登録商標)907(商品名))

[0244] <樹脂組成物の評価>

実施例1~8及び比較例1~3の樹脂組成物について、以下に示す評価を行った。その結果を表1にまとめて示した。

[0245] [感度]

実施例1~8及び比較例1~3で得られた感光性樹脂組成物を銅貼積層板(住友ベークライト(株)ELC4762)上にアプリケーションで塗布して、温度80℃において30分間加熱し、膜厚20μmの塗膜を形成した。次いで、波長405nm(h線)を含む活性エネルギー線を照射可能な光源(U SHI0(株)製超高压水銀灯USH-500BY1(商品名))を用いて、21段ステップタブレットを用いて、現像後の残存段数が7段となる露光量に

て投影露光機で露光した。

以下の基準にて感度を評価し、評価結果を表1に示した。

[評価基準]

◎：露光量 500 mJ/cm^2 未満で7段残存

○：露光量 500 mJ/cm^2 以上 1000 mJ/cm^2 未満で7段残存

△：露光量 1000 mJ/cm^2 以上 3000 mJ/cm^2 未満で7段残存

×：露光量 3000 mJ/cm^2 以上でも硬化せず

[0246] [引張弾性率]

先ず、厚み $12\text{ }\mu\text{m}$ の超低粗度電解銅箔（CF-T4X-SV（商品名）、福田金属箔粉工業株式会社製）上に各実施例及び比較例で得られた感光性樹脂組成物をアプリケーションを用いて塗布後、温度 80°C において30分間乾燥させ、銅箔上にフィルム状感光性樹脂組成物を形成させた。乾燥後のフィルム状感光性樹脂組成物の膜厚は $20\text{ }\mu\text{m}$ となるように感光性樹脂組成物の塗布厚みを調整した。このフィルム状感光性樹脂組成物に対して、波長 405 nm （h線）を含む活性エネルギー線を照射可能な光源（USHIO（株）製超高圧水銀灯 500 W マルチライト（商品名））を用いて、露光量 3000 mJ/cm^2 にて露光を行い、次いで、温度 180°C において60分間加熱して硬化させた後、銅箔をエッチングによって除去することにより、硬化膜を得た。

[0247] 次いで、得られた硬化膜を $6\text{ cm}\times 5\text{ mm}$ の試験片に切断し、引っ張り試験機（商品名「RTG-1201」株式会社エー・アンド・デイ製）にて、 25°C で 5 mm/min の速度にて引張弾性率（MPa）と破断伸度（%）を測定した。

[0248] [誘電特性]

銅箔積層体の銅箔をエッチングにより除去し、 130°C で30分乾燥させた後、樹脂フィルムの硬化物を切断して $10\text{ cm}\times 5\text{ cm}$ の試験片を作製した。得られた試験片について、空洞共振器法誘電率測定装置（株式会社エーイーティー製）にて、 10 GHz での比誘電率及び誘電正接を測定した。測

定後、試験片を24時間水に浸漬して吸水後、水から取り出して水分を拭き取り、25℃30%の環境に一日放置したのち、再び10GHzでの比誘電率及び誘電正接を測定した。

[0249] [ガラス転移温度]

銅箔積層体の両面の銅箔をエッチングにより除去し、130℃で30分乾燥させた後、樹脂フィルムの硬化物を切断して5cm×5mmの試験片を作製した。得られた試験片について、動的粘弾性試験機（DMA：商品名「RSA-G2」、TA Instruments製）により測定し、 $\tan \delta$ が最大値のときの温度をガラス転移温度として求めた。

[0250] [吸水率]

銅箔積層体の両面の銅箔をエッチングにより除去し、130℃で30分乾燥させた後、樹脂フィルムの硬化物を切断して10cm×5cmの試験片を作製した。得られた試験片を24時間水に浸漬して吸水後、水から取り出して水分を拭き取った後、試験片の重量増加率を吸水率とした。

[0251] [HAST耐性]

各組成物を、スクリーン印刷法により25 μm の厚さになるようにL/S=100 μm /100 μm のくし型パターンが形成されたエスパネックスMシリーズ（新日鐵化学製：ベースイミド厚25 μm Cu厚18 μm ）上に塗布し、塗膜を80℃の熱風乾燥器で60分乾燥させた。次いで、アフレックス（Grade：25N NT）（AGC株式会社製）を樹脂面に被せ、220℃で2時間加熱することによって、HAST評価用の試験基板を得た。得られた基板の電極部分をはんだによる配線接続を行い、130℃、85%RHの環境下に置き、100Vの電圧をかけ、抵抗値が $1 \times 10^8 \Omega$ 以下となるまでの時間を測定した。

○…300時間以上

△…30～300時間

×…30時間以下

[0252]

[表1]

成分	材料	実施例								比較例			
		1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	
ビスマレイミド化合物(A)	A-1	85	85	85	85	85	85	85	85				
	A'-1									85			
	A'-2 A'-3										85	85	
樹脂又は化合物(B)	B-1 ビスマレイミド化合物	10						10	10	10	10	10	
	B-2 シアン酸エステル樹脂		10										
	B-3 ベンゾオキサジジン化合物			10									
	B-4 エポキシ樹脂				10								
	B-5 カルボジミド化合物					10							
	B-6 エチレン性不飽和基を有する化合物						10						
光重合開始剤(C)	C-1 Omnirad 819	5	5	5	5	5				5	5	5	
	C-2 Omnirad 369							5					
	C-3 Omnirad 907								5				
溶剤	トルエン	30	30	30	30	30	30	30	30			30	
光硬化性	感度(mJ/cm ²)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	×	○	◎	
誘電特性	誘電率 Dk	2.2	2.3	2.3	2.4	2.3	2.5	2.2	2.2	—	*1	2.4	2.3
	誘電正接 Df	0.0032	0.0034	0.0034	0.0043	0.0035	0.0044	0.0035	0.0038	—	—	0.0035	0.0034
	吸水後 誘電率 Dk	2.2	2.3	2.3	2.5	2.3	2.5	2.2	2.2	—	*2	2.4	2.3
	吸水後 誘電正接 Df	0.0033	0.0034	0.0035	0.0048	0.0035	0.0050	0.0037	0.0038	—	*2	0.0052	0.0054
機械物性	引張強性率(MPa)	675	710	688	632	540	607	666	658	—	*2	520	470
	破断点伸度(%)	72	68	69	70	73	71	67	66	—	*2	58	51
耐熱性	Tg(°C)	111	114	110	96	92	98	108	106	—	*2	86	77
	吸水率(%)	0.05	0.05	0.06	0.18	0.04	0.16	0.05	0.06	—	*2	0.34	0.23
絶縁信頼性	HAST耐性	○	○	○	○	○	○	○	○	—	*2	△	△

*1: 3000mJ/cm²露光でも硬化膜が得られなかった。

*2: 硬化膜を得ることができなかつたため未測定。

[0253] 表1から明らかなように、本実施形態によれば、波長200~600nmを含む活性エネルギー線のいずれの光線で露光した場合においても良好に感光し、光硬化が可能である。

また、実施例1~8の樹脂組成物は、その硬化物の特性として、低誘電特性かつ吸水後の誘電特性に変化が小さく、低弾性でかつ高伸度、高耐熱でかつ低吸水性であり、優れた絶縁信頼性有していることが確認できた。

産業上の利用可能性

[0254] 本実施形態の樹脂組成物は、光硬化性及びアルカリ現像性に優れるため、工業的に有用であり、例えば、感光性フィルム、支持体付き感光性フィルム、プリプレグ、樹脂シート、回路基板（積層板用途、多層プリント配線板用途等）、ソルダーレジスト、アンダーフィル材、ダイボンディング材、半導体封止材、穴埋め樹脂、部品埋め込み樹脂、繊維強化複合材料等の用途に使用することができる。

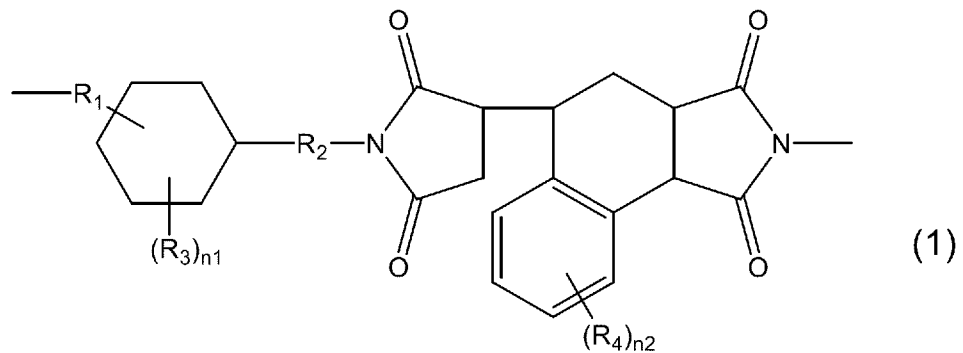
請求の範囲

[請求項1] 下記式（1）で表される構成単位と、分子鎖の両末端にマレイミド基と、を含む、ビスマレイミド化合物（A）と、

前記ビスマレイミド化合物（A）以外のマレイミド化合物、シアン酸エステル化合物、ベンゾオキサジン化合物、エポキシ樹脂、カルボジイミド化合物、及びエチレン性不飽和基を有する化合物からなる群より選択される少なくとも1種以上の樹脂又は化合物（B）と、

光硬化開始剤（C）と、を含む、樹脂組成物。

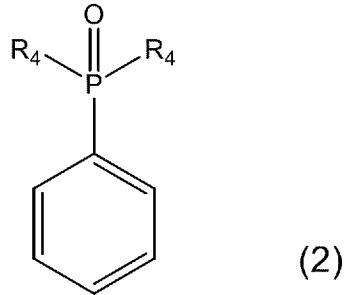
[化1]



（式（1）中、 R_1 は、炭素数1～16の直鎖状若しくは分岐状のアルキレン基、又は炭素数2～16の直鎖状若しくは分岐状のアルケニレン基を示す。 R_2 は、炭素数1～16の直鎖状若しくは分岐状のアルキレン基、又は炭素数2～16の直鎖状若しくは分岐状のアルケニレン基を示す。 R_3 は、各々独立に、水素原子、炭素数1～16の直鎖状若しくは分岐状のアルキル基、又は炭素数2～16の直鎖状若しくは分岐状のアルケニル基を示す。 R_4 は、各々独立に、水素原子、炭素数1～6の直鎖状若しくは分岐状のアルキル基、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、又は炭素数1～6の直鎖状若しくは分岐状のアルコキシ基を示す。 n_1 は、各々独立に、1～4の整数を示す。 n_2 は、各々独立に、1～4の整数を示す。）。

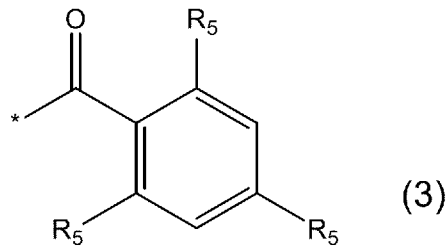
[請求項2] 前記光硬化開始剤（C）が、下記式（2）で表される化合物を含む、請求項1に記載の樹脂組成物。

[化2]



(式(2)中、 R_4 は、各々独立に、下記式(3)で表される置換基又はフェニル基を表す。)

[化3]



(式(3)中、 $*$ は結合手を示し、 R_5 は、各々独立に、水素原子又はメチル基を表す。)

[請求項3] 前記ビスマレイミド化合物(A)と前記樹脂又は化合物(B)と前記光硬化開始剤(C)の総量を100質量部とした場合、前記式(1)で表されるビスマレイミド樹脂の含有量が5～99.4質量部である、請求項1または2に記載の樹脂組成物。

[請求項4] 充填材を更に含む、請求項1～3のいずれか一項に記載の樹脂組成物。

[請求項5] 請求項1～4のいずれか一項に記載の樹脂組成物を含む、硬化物。

[請求項6] 支持体と、

前記支持体の片面又は両面に配された樹脂層と、を有し、
前記樹脂層が、請求項1又は2に記載の樹脂組成物を含む、
樹脂シート。

[請求項7] 前記樹脂層の厚さが1～50 μ mである、請求項6に記載の樹脂シ

ート。

[請求項8]

基材と、

前記基材に含浸又は塗布された、請求項1～4のいずれか一項に記載の樹脂組成物と、を含む、プリプレグ。

[請求項9]

請求項7に記載の樹脂シート、及び請求項8に記載のプリプレグからなる群より選ばれる少なくとも1種を含む層と、

前記層の片面又は両面に配された金属箔と、を有し、前記層が、前記樹脂組成物の硬化物を含む、金属箔張積層板。

[請求項10]

絶縁層と、

前記絶縁層の片面又は両面に形成された導体層と、

を有し、前記絶縁層が、請求項1～4のいずれか一項に記載の樹脂組成物を含む、多層プリント配線板。

[請求項11]

請求項1～4のいずれか一項に記載の樹脂組成物を含む、封止用材料。

[請求項12]

請求項1～4のいずれか一項に記載の樹脂組成物と、強化繊維と、を含む、繊維強化複合材料。

[請求項13]

請求項1～4のいずれか一項に記載の樹脂組成物を含む、接着剤。

[請求項14]

請求項1～4のいずれか一項に記載の樹脂組成物を有する、半導体装置。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2021/040619

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER		
<p><i>C08G 73/12</i>(2006.01)i; <i>B32B 15/08</i>(2006.01)i; <i>B32B 27/26</i>(2006.01)i; <i>B32B 27/34</i>(2006.01)i; <i>C08J 5/24</i>(2006.01)i; <i>C08K 5/5397</i>(2006.01)i; <i>C08L 79/08</i>(2006.01)i; <i>C09J 179/04</i>(2006.01)i; <i>H01L 23/29</i>(2006.01)i; <i>H01L 23/31</i>(2006.01)i; <i>H05K 1/03</i>(2006.01)i</p> <p>FI: C08G73/12; C08L79/08; C08K5/5397; C08J5/24 CEZ; H05K1/03 610P; B32B15/08 U; B32B27/26; B32B27/34; C09J179/04 B; H01L23/30 R; H05K1/03 630H</p> <p>According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC</p>		
B. FIELDS SEARCHED		
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)		
C08G73/00-73/26; B32B15/08; B32B27/26; B32B27/34; C08J5/24; C08K5/5397; C08L79/08; C09J179/04; H01L23/29; H01L23/31; H05K1/03		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched		
<p>Published examined utility model applications of Japan 1922-1996</p> <p>Published unexamined utility model applications of Japan 1971-2022</p> <p>Registered utility model specifications of Japan 1996-2022</p> <p>Published registered utility model applications of Japan 1994-2022</p>		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)		
CAplus/REGISTRY (STN)		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	WO 2020/189354 A1 (NIPPON KAYAKU KK) 24 September 2020 (2020-09-24) claims 1, 7-9, 12, paragraphs [0005], [0021], [0024], [0033]-[0034], [0036], [0048], [0052], [0055], [0057], [0059], [0062], [0064]-[0071], tables 1-4, examples 2, 4, 6	1-14
Y	WO 2020/203834 A1 (NIPPON KAYAKU KK) 08 October 2020 (2020-10-08) claims 1-14, paragraphs [0072], [0079], [0092], [0099], [0103], [0108]-[0118], [0121], table 1, example 4, comparative example 2	1-14
A	JP 2018-016793 A (CHIN YEE CHEMICAL INDUSTRIES CO., LTD.) 01 February 2018 (2018-02-01) entire text	1-14
A	JP 6825368 B2 (ARAKAWA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.) 03 February 2021 (2021-02-03) entire text	1-14
<input checked="" type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input checked="" type="checkbox"/> See patent family annex.		
<p>* Special categories of cited documents:</p> <p>“A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance</p> <p>“E” earlier application or patent but published on or after the international filing date</p> <p>“L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)</p> <p>“O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means</p> <p>“P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed</p> <p>“T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention</p> <p>“X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone</p> <p>“Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art</p> <p>“&” document member of the same patent family</p>		
Date of the actual completion of the international search		Date of mailing of the international search report
06 January 2022		18 January 2022
Name and mailing address of the ISA/JP		Authorized officer
Japan Patent Office (ISA/JP) 3-4-3 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8915 Japan		
		Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2021/040619

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2014-132326 A (JSR CORP.) 17 July 2014 (2014-07-17) entire text	1-14
E, A	JP 6981522 B1 (TOYO INK SC HOLDINGS CO., LTD.) 15 December 2021 (2021-12-15) entire text	1-14

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/JP2021/040619

Patent document cited in search report			Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)			Publication date (day/month/year)
WO	2020/189354	A1	24 September 2020	JP	2020-172667	A	
WO	2020/203834	A1	08 October 2020	(Family: none)			
JP	2018-016793	A	01 February 2018	TW	201803918	A	
				TW	1582136	B	
JP	6825368	B2	03 February 2021	JP	2017-121807	A	
				KR	10-2017-0082130	A	
				CN	107009697	A	
				TW	201736118	A	
JP	2014-132326	A	17 July 2014	CN	103849406	A	
				KR	10-2014-0071225	A	
				TW	201422679	A	
JP	6981522	B1	15 December 2021	(Family: none)			

<p>A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC））</p> <p>C08G 73/12(2006.01)i; B32B 15/08(2006.01)i; B32B 27/26(2006.01)i; B32B 27/34(2006.01)i; C08J 5/24(2006.01)i; C08K 5/5397(2006.01)i; C08L 79/08(2006.01)i; C09J 179/04(2006.01)i; H01L 23/29(2006.01)i; H01L 23/31(2006.01)i; H05K 1/03(2006.01)i FI: C08G73/12; C08L79/08; C08K5/5397; C08J5/24 CEZ; H05K1/03 610P; B32B15/08 U; B32B27/26; B32B27/34; C09J179/04 B; H01L23/30 R; H05K1/03 630H</p>																	
<p>B. 調査を行った分野</p> <p>調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC））</p> <p>C08G73/00-73/26; B32B15/08; B32B27/26; B32B27/34; C08J5/24; C08K5/5397; C08L79/08; C09J179/04; H01L23/29; H01L23/31; H05K1/03</p> <p>最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの</p> <table border="0"> <tr> <td>日本国実用新案公報</td> <td>1922-1996年</td> </tr> <tr> <td>日本国公開実用新案公報</td> <td>1971-2022年</td> </tr> <tr> <td>日本国実用新案登録公報</td> <td>1996-2022年</td> </tr> <tr> <td>日本国登録実用新案公報</td> <td>1994-2022年</td> </tr> </table> <p>国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）</p> <p>CAplus/REGISTRY (STN)</p>			日本国実用新案公報	1922-1996年	日本国公開実用新案公報	1971-2022年	日本国実用新案登録公報	1996-2022年	日本国登録実用新案公報	1994-2022年							
日本国実用新案公報	1922-1996年																
日本国公開実用新案公報	1971-2022年																
日本国実用新案登録公報	1996-2022年																
日本国登録実用新案公報	1994-2022年																
<p>C. 関連すると認められる文献</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>引用文献の カテゴリー*</th> <th>引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示</th> <th>関連する 請求項の番号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Y</td> <td>WO 2020/189354 A1（日本化薬株式会社）24.09.2020（2020-09-24） [請求項1]、[請求項7]～[請求項9]、[請求項12]、[0005]、[0021]、[0024]、[0033]～[0034]、[0036]、[0048]、[0052]、[0055]、[0057]、[0059]、[0062]、[0064]～[0071]、[表1]～[表4]、実施例2、4、6</td> <td>1-14</td> </tr> <tr> <td>Y</td> <td>WO 2020/203834 A1（日本化薬株式会社）08.10.2020（2020-10-08） [請求項1]～[請求項14]、[0072]、[0079]、[0092]、[0099]、[0103]、[0108]～[0118]、[0121]、[表1]、実施例4、比較例2</td> <td>1-14</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>JP 2018-016793 A（晉一化工股▲ふん▼有限公司）01.02.2018（2018-02-01） 全文</td> <td>1-14</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>JP 6825368 B2（荒川化学工業株式会社）03.02.2021（2021-02-03） 全文</td> <td>1-14</td> </tr> </tbody> </table>			引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号	Y	WO 2020/189354 A1（日本化薬株式会社）24.09.2020（2020-09-24） [請求項1]、[請求項7]～[請求項9]、[請求項12]、[0005]、[0021]、[0024]、[0033]～[0034]、[0036]、[0048]、[0052]、[0055]、[0057]、[0059]、[0062]、[0064]～[0071]、[表1]～[表4]、実施例2、4、6	1-14	Y	WO 2020/203834 A1（日本化薬株式会社）08.10.2020（2020-10-08） [請求項1]～[請求項14]、[0072]、[0079]、[0092]、[0099]、[0103]、[0108]～[0118]、[0121]、[表1]、実施例4、比較例2	1-14	A	JP 2018-016793 A（晉一化工股▲ふん▼有限公司）01.02.2018（2018-02-01） 全文	1-14	A	JP 6825368 B2（荒川化学工業株式会社）03.02.2021（2021-02-03） 全文	1-14
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号															
Y	WO 2020/189354 A1（日本化薬株式会社）24.09.2020（2020-09-24） [請求項1]、[請求項7]～[請求項9]、[請求項12]、[0005]、[0021]、[0024]、[0033]～[0034]、[0036]、[0048]、[0052]、[0055]、[0057]、[0059]、[0062]、[0064]～[0071]、[表1]～[表4]、実施例2、4、6	1-14															
Y	WO 2020/203834 A1（日本化薬株式会社）08.10.2020（2020-10-08） [請求項1]～[請求項14]、[0072]、[0079]、[0092]、[0099]、[0103]、[0108]～[0118]、[0121]、[表1]、実施例4、比較例2	1-14															
A	JP 2018-016793 A（晉一化工股▲ふん▼有限公司）01.02.2018（2018-02-01） 全文	1-14															
A	JP 6825368 B2（荒川化学工業株式会社）03.02.2021（2021-02-03） 全文	1-14															
<p><input checked="" type="checkbox"/> C欄の続きにも文献が列挙されている。 <input checked="" type="checkbox"/> パテントファミリーに関する別紙を参照。</p>																	
<table border="0"> <tr> <td>* 引用文献のカテゴリー</td> <td>“T” 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と抵触するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの</td> </tr> <tr> <td>“A” 特に関連のある文献ではなく、一般的な技術水準を示すもの</td> <td>“X” 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの</td> </tr> <tr> <td>“E” 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの</td> <td>“Y” 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの</td> </tr> <tr> <td>“L” 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）</td> <td>“&” 同一パテントファミリー文献</td> </tr> <tr> <td>“O” 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献</td> <td></td> </tr> <tr> <td>“P” 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願の日の後に公表された文献</td> <td></td> </tr> </table>			* 引用文献のカテゴリー	“T” 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と抵触するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの	“A” 特に関連のある文献ではなく、一般的な技術水準を示すもの	“X” 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの	“E” 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの	“Y” 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの	“L” 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）	“&” 同一パテントファミリー文献	“O” 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献		“P” 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願の日の後に公表された文献				
* 引用文献のカテゴリー	“T” 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と抵触するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの																
“A” 特に関連のある文献ではなく、一般的な技術水準を示すもの	“X” 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの																
“E” 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの	“Y” 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの																
“L” 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）	“&” 同一パテントファミリー文献																
“O” 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献																	
“P” 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願の日の後に公表された文献																	
<p>国際調査を完了した日</p> <p>06.01.2022</p>	<p>国際調査報告の発送日</p> <p>18.01.2022</p>																
<p>名称及びあて先</p> <p>日本国特許庁(ISA/JP) 〒100-8915 日本国 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号</p>	<p>権限のある職員（特許庁審査官）</p> <p>藤井 明子 4J 5813</p> <p>電話番号 03-3581-1101 内線 3457</p>																

C. 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリ*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
A	JP 2014-132326 A (J S R株式会社) 17.07.2014 (2014 - 07 - 17) 全文	1-14
E, A	JP 6981522 B1 (東洋インキ S Cホールディングス株式会社) 15.12.2021 (2021 - 12 - 15) 全文	1-14

国際調査報告
 パテントファミリーに関する情報

国際出願番号

PCT/JP2021/040619

引用文献			公表日	パテントファミリー文献			公表日
WO	2020/189354	A1	24.09.2020	JP	2020-172667	A	
WO	2020/203834	A1	08.10.2020	(ファミリーなし)			
JP	2018-016793	A	01.02.2018	TW	201803918	A	
				TW	1582136	B	
JP	6825368	B2	03.02.2021	JP	2017-121807	A	
				KR	10-2017-0082130	A	
				CN	107009697	A	
				TW	201736118	A	
JP	2014-132326	A	17.07.2014	CN	103849406	A	
				KR	10-2014-0071225	A	
				TW	201422679	A	
JP	6981522	B1	15.12.2021	(ファミリーなし)			